

| GESCHÄFTSBERICHT 2002

DIE GESCHÄFTSJAHRE 2001 UND UND 2002 AUF EINEN BLICK

Millionen Euro	2002	2001
Auftragseingang netto	104,5	156,0
Auftragsbestand netto	32,4	57,6
Nettoumsatz	127,5	214,8
Eigenkapital	118,5	95,4
Eigenkapitalquote	68%	50%
Net cash	13,4	-22,1
Free cash flow	-0,1	-9,9
Rohertrag nach Umgliederungen	47,9	114,3
Rohertragsmarge	37,6%	53,2%
EBITDA	-9,4	50,4
EBITDA-Marge	-7,4%	23,5%
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-8,9	21,1
EPS (Ergebnis pro Aktie in EURO)	-0,60	1,53
Anzahl der Mitarbeiter (Q1/03: 730)	878	955

| INHALT

Editorial	4
Bericht des Aufsichtsrats	6
1. Meilensteine 2002	8
2. Märkte	10
3. SECAP	17
4. Investor Relations	16
5. Corporate Governance	20
Konzernlagebericht	22
Finanzdaten	34
Unternehmenskalender	41
Anhang zum Konzernabschluß	42
Bestätigungsvermerk	72

EDITORIAL



Stephan Schulak, Dr. Franz Richter

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

wir blicken auf das Geschäftsjahr 2002 als eines der schwierigsten Jahre in der Halbleiterindustrie zurück. Schon zu Beginn des Jahres bewegte sich die Industrie auf einer zyklischen Talfahrt, die sich durch die allgemeine Konjunkturlaute bzw. Rezession noch verstärkte. Gründe für diesen Negativtrend sehen wir unter anderem darin, dass die Nachfrage nach elektronischen Geräten auf Seiten der Endverbraucher sich derzeit noch nicht wieder erholt hat. Die anfänglich viel zu hohen Lagerbestände bei den Halbleiterherstellern sind zwar inzwischen überwiegend abgebaut worden; Investitionen in neues Produktions-Equipment wird aber erst wieder mit steigendem Absatz von Mikrochips erfolgen. Dies zeigt sich in den Verkaufspreisen für Speicherchips, den DRAM's, die in vielen Fällen noch immer unter den Herstellkosten liegen. Insbesondere die Telekommunikationsindustrie hat sich noch nicht von ihrem Einbruch im Jahr 2001 erholt. Auch wenn sich inzwischen wieder einige positive Entwicklungen der Nachfrage zeigen, so wird doch allgemein von einer nur langsamen Erholung der gesamten Halbleiterindustrie ausgegangen.

Von Anfang 2002 bis noch vor einigen Monaten rechneten Industrie, Analysten und Politiker mit einer nachhaltigen Erholung der Märkte im zweiten Halbjahr 2002. Im zweiten Quartal zeigte sich auch für die SÜSS MicroTec AG eine kurzfristige Auftragsbelegung in den USA. Insgesamt jedoch haben sich die Hoffnungen auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr 2002 zerschlagen; die allgemeine Stimmung am Markt blieb entgegen den Erwartungen weiter negativ. Dies führte dazu, dass ursprüngliche Unternehmensplanungen für 2002 branchenweit revidiert werden mussten.

Gegenüber dem Jahr 2001, in dem wir der Halbleiterkrise noch trotzen konnten, sank unser Umsatz in 2002 um 41% auf 127,5 Millionen Euro. Besonders einschneidend waren die

Umsatzrückgänge in den USA und in Japan, wo wird dann auch entsprechende Verluste erwirtschafteten. Der Auftragszugang entwickelte sich bereits im 2. Halbjahr 2001 in allen Regionen rückläufig – eine Entwicklung, die sich auch 2002 entsprechend der Verfassung des Marktes weiter fortsetzte. Im Berichtsjahr generierten wir mit 104 Millionen Euro nochmal 33% weniger Auftragsvolumen als 2001.

In einer derartigen Situation ist es die Verantwortung des Managements, bestehenden und aufkommenden Risiken für das Unternehmen mit adäquaten Maßnahmen zu entgegnen. Dabei ist die Sicherung der Liquidität von herausragender Bedeutung. Trotz des schwierigen Jahres 2002 mit einem entsprechend negativen Ergebnisverlauf weist die SÜSS MicroTec-Gruppe weiterhin eine sehr solide Eigenkapitalfinanzierung auf. Vor allem auch durch die im Januar 2002 durchgeführte Kapitalerhöhung bedingt, betrug die Eigenkapitalquote zum Jahresende 68%. Um unseren Bedarf an Fremdkapital möglichst gering zu halten, streben wir eine weiterhin hohe Eigenkapitalquote an.

Eine weitere wesentliche Aufgabe des Managements ist die bedarfsgerechte Gestaltung der Unternehmensstruktur. Vor dem Hintergrund der schwachen Nachfrage nach Produkten entstanden Überkapazitäten im Produktionsbereich, die ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm erforderlich machten. Der Vorstand kam diesen Anforderungen auch durch einen teilweise sehr schmerzhaften Mitarbeiterabbau nach. Von den Anfang letzten Jahres noch über 1.000 Mitarbeitern im Konzern musste die Belegschaft im Jahr 2002 um über 250 Mitarbeiter reduziert werden. Der Vorstand war und ist sich stets seiner Verantwortung sowohl gegenüber den von den Kündigungen betroffenen Mitarbeitern als auch gegenüber den Mitarbeitern, die im Unternehmen verbleiben, bewusst. Diese Maßnahmen bedeuten letztendlich die Zukunftssicherung für die SÜSS MicroTec AG und ihre Tochterunternehmen.

Weitere entscheidende Ereignisse des Jahres 2002 waren:

- die Kapitalerhöhung im Januar. 1.130.000 nennwertlose Stückaktien wurden im Rahmen eines Accelerated Book-buildings bei institutionellen Anlegern platziert; die finanzielle Position des Unternehmens nachhaltig gestärkt;
- die Übernahme der Vermögensgegenstände der B.L.E. Laboratory Equipment GmbH, Singen, im ersten Quartal;
- die Umstrukturierung der Vorstandsebene. Im April wurde Stephan Schulak zum neuen Finanzvorstand (CFO) berufen; Claus Lichtenberg, der bisherige Vorstand Operations (COO) ist Ende Oktober im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden;
- die Bestnoten bei der „Umfrage zur Kundenzufriedenheit“ der namhaften VLSI Research, Inc.

Die künftige Entwicklung der von SÜSS MicroTec bedienten Märkte stellt sich aus heutiger Sicht weiterhin sehr positiv dar. Die Industrie entwickelt auch in Zukunft neue Produkte, die neue Technologien zum Beispiel in den Bereichen des Chip-Packagings oder der Mikrosystemtechnik erfordern. So sicher, wie niemand von uns wieder auf den Stand beispielsweise eines 386er PC mit 60 MB Festplatte zurückkehren möchte, so sicher wird sich auch künftig niemand dem weiteren Fortschritt verschließen. Der Trend zu neuen, ausgefeilteren, profitableren und komfortableren Technologien und Anwendungen wird sich in allen Lebensbereichen fortsetzen. Beständig steigende Funktionalität und Leistungsfähigkeit von immer kleineren Geräten hat zwangsläufig Miniaturisierung zur Folge. Auch der Halbleitermarkt wird nach wie vor einem rasanten Wandel unterliegen und damit weiterhin Moore's Gesetz folgen. Dieses besagt, dass sich die Datendichte auf einem Chip alle 18 Monate verdoppelt. Die Kurzlebigkeit der elektronischen Produkte zeigt die Innovationsgeschwindigkeit in diesen Märkten – unseren Wachstumsmärkten Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Test & Measurement, die auch in Zukunft ein enormes Potenzial besitzen.

Die derzeitige Krise der Halbleiterindustrie, die auch uns in 2002 erfasste, ist eine der längsten in unserer 50-jährigen Firmengeschichte. Jedoch folgte in der Vergangenheit auf jeden Abschwung immer wieder ein Aufschwung – dies wird sich auch diesmal wieder so darstellen. Wir haben im abgelaufenen Jahr die freien Kapazitäten genutzt, um unsere strategische Position im Markt weiter zu optimieren. So führten wir trotz aller Personalabbaumaßnahmen die F&E-Projekte weiter und entwickelten eine ganze Reihe neuer Produkte und Technologien bzw. brachten diese auf den Markt. Wir setzen darauf, die künftige Wettbewerbsfähigkeit durch kontinuierliche Innovation zu gewährleisten, weshalb der Forschungs- und Entwicklungsbereich von Kürzungen und Restrukturierungsmaßnahmen weit weniger betroffen ist als andere Unternehmensebenen.

Für das laufende Jahr sehen mehrere Marktforscher und Analysten gegenwärtig positive Tendenzen und erwarten wieder steigende Umsätze in der Halbleiterindustrie. Voraussetzung

hierfür ist jedoch ein baldig steigender Konsum an elektronischen Produkten. Die derzeitige Entwicklung der entsprechenden Märkte, die schleppende Erholung der Weltkonjunktur und die großen geopolitischen Risiken veranlassen uns – zumindest für das erste und das zweite Quartal 2003 – zu weniger optimistischen Planungen. Aus heutiger Sicht scheinen bis zur Jahresmitte 2003 Umsatzziele noch unter den Vorjahreszahlen realistisch. Ein wichtiger Faktor hierbei ist u.a. die Entwicklung des US-Dollar-EURO Wechselkurses. Bei den Umsätzen unserer Tochter in den USA generieren wir einen erheblichen Anteil der Wertschöpfung im EURO-Währungsraum und profitierten somit in der Vergangenheit deutlich von einem starken US-Dollar. Aufgrund der genannten weltweiten Rahmenbedingungen kann für das Gesamtjahr 2003 keine realistische Prognose abgegeben werden. Unter Betrachtung verschiedener möglicher Szenarien ergibt sich eine breite Spanne möglicher Umsätze, die von deutlich über 150 Millionen EURO bis zu unter 100 Millionen EURO reicht. Weil sich die bislang gültigen Indikatoren bereits im vergangenen Jahr als unzuverlässig erwiesen haben, lassen sich deshalb zu gegenwärtigen Zeitpunkt des Geschäftsjahres noch keine Prognosen auf das Gesamtjahr angeben.

Sehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner das vergangene Jahr ist sicherlich alles andere als zufriedenstellend verlaufen – im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung und auch im Blick auf die Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie. Gerade deshalb danken wir Ihnen ganz besonders für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Auch wenn die schwierige Zeit noch nicht überwunden ist, so haben wir heute alle notwendigen Schritte getan, um das Unternehmen kurzfristig gegen Risiken abzusichern und auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Im Hinblick auf die mittelfristige Geschäftsentwicklung sind wir fest überzeugt, dass wir mit unseren innovativen erstklassigen Produkten, in äußerst interessanten Wachstumsmärkten etabliert sind. An dem nächsten Aufschwung in der Halbleiterindustrie werden wir wieder voll partizipieren und von der Zuverlässigkeit und der Innovationskraft unserer Produkte profitieren.

Garching, im März 2003



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak
Vorstand Finanzen

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2002 regelmäßig durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in vier gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und des SÜSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands auch dahingehend überwacht, dass Abweichungen des tatsächlichen Geschäftsverlaufs von der Planung unter Angabe ihrer Gründe ausführlich mit dem Vorstand erörtert wurden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken unterrichtet.

Zum 1. April 2002 hat der Aufsichtsrat Herrn Stefan Schulak zum stellvertretenden Mitglied und zum 1. April 2003 zum ordentlichen Mitglied des Vorstands bestellt. Zum 31. Oktober 2002 ist Herr Claus Lichtenberg aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Seine Aufgaben haben die Herren Dr. Richter und Schulak übernommen.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem die Herren Dr. Süss als Vorsitzender sowie Schlytter-Henrichsen und Görtz als Mitglieder angehören, hat sich in fünf Sitzungen mit Personalangelegenheiten des Vorstands befasst, die Entscheidungen des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten vorbereitet und dem Gesamtaufichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen berichtet.

Der im März 2002 gebildete Finanzausschuss des Aufsichtsrats, dem im Geschäftsjahr 2002 die Herren Dr. Süss als Vorsitzender und Schlytter-Henrichsen und Dr. Schücking

als Mitglieder angehörten, hat sich in einer Sitzung und zwei Telefonkonferenzen mit Finanzangelegenheiten und Problemen der Anpassung der SÜSS MicroTec-Gruppe an das zurückgegangene Geschäftsvolumen befasst und den Gesamtaufsichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen unterrichtet.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2003, hat der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss eingesetzt und die Aufgaben des bisherigen Finanzausschusses dem Prüfungsausschuss zugewiesen, mit dessen Vorsitz Herr Schlytter-Henrichsen beauftragt wurde. Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die Herren Prof. Dr. Heuberger, Dr. Schücking und Dr. Süß.

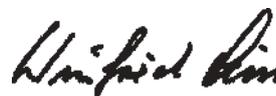
Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, der nach den als US-GAAP bezeichneten Bilanzierungsregeln der Vereinigten Staaten von Amerika aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2002, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2002 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, die PriceWaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2002 sowie den gemäß § 292a des Handelsgesetzbuchs nach US-GAAP aufgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2002, den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2002 geprüft. An der Verhandlung des Aufsichtsrats über die genannten Vorlagen haben die beiden zuständigen Wirtschaftsprüfer des

Abschlussprüfers teilgenommen. Sie haben dem Aufsichtsrat mündlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Abschlussprüfers mit den Vertretern des Abschlussprüfers und dem Vorstand erörtert und die Vorlagen gebilligt. Der Aufsichtsrat erklärt hiermit, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung gegen die von ihm geprüften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2002 ist damit festgestellt. Mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2002 ist der Aufsichtsrat einverstanden.

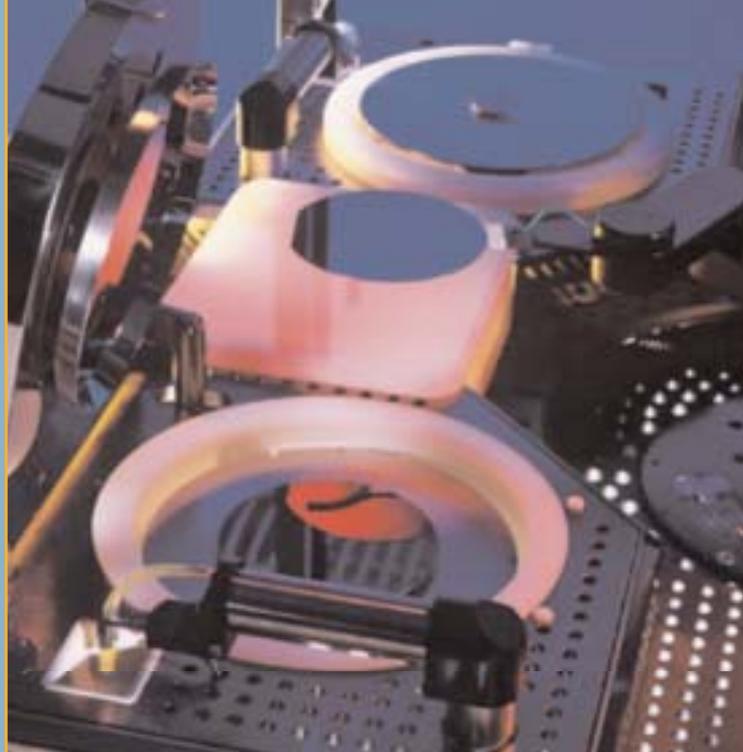
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften für ihren Einsatz für die Gesellschaft und den SÜSS MicroTec Konzern im schwierigen Geschäftsjahr 2002, das ihnen ein hohes Maß an Einsatz und die Fähigkeit zur Anpassung an das stark veränderte wirtschaftliche Umfeld abverlangt hat.

Garching, im März 2003
Der Aufsichtsrat



Dr. Winfried Süß
Vorsitzender

1. MEILENSTEINE 2002



Position im 300mm-Bereich ausgebaut

Im abgelaufenen Geschäftsjahr festigte und stärkte SÜSS MicroTec seine Position im 300mm-Technologiebereich mit wesentlichen strategischen Erfolgen. Wir erhielten für unser Equipment mit der Zukunftstechnologie – auch in einem äußerst schwierigen Marktumfeld – bedeutende Aufträge weltweit führender Unternehmen der Halbleiterbranche. So bestellten einige der weltweit größten Dienstleister für Halbleiter Testing- und Packaging (sogenannte Foundries) in 2002 erstmals 300mm-Equipment – und wesentliche Anteile davon bei SÜSS MicroTec. Die größten Packaging-Foundries in Taiwan, ASE und SPIL arbeiten im 300mm-Bereich bereits in dieser sehr frühen Phase der 300mm-Implementierung mit SÜSS MicroTec-Maschinen. Ebenso entscheidend ist in diesem Zusammenhang der jüngste Erfolg mit dem internationalen Konsortium SECAP. In einer 300mm-SECAP Produktionslinie für Advanced Packaging, die bei der Packaging-Foundry Unitive Taiwan Corporation (UTC), Hsinchu, Taiwan installiert wird, sind die SÜSS MicroTec-Maschinen Mask Aligner, Coater und Developer in einer kompletten Produktionsprozesslinie eingebunden (vgl. S. 17).

Viele Halbleiterunternehmen lagern derzeit ihre Packaging-Produktion im 300mm-Bereich an Foundries aus - und die Tendenz zum Outsourcing steigt weiter. Gerade bei den Packaging-Foundries ist SÜSS MicroTec heute hervorragend aufgestellt und für weiteres Wachstum gerüstet.

Service weltweit optimiert

In 2002 legte SÜSS MicroTec den Grundstein für schnelleren und umfassenderen Service im wichtigen Wachstumsmarkt Asien. So wurde der Übergang von den bisherigen Repräsentationsbüros zu eingetragenen eigenständigen Firmen in Taiwan und in China eingeleitet. Mit dem Aufbau einer effizienteren Service-Organisation in direkter Nachbarschaft zu wichtigen Kun-

den trägt die Firma den erhöhten Anforderungen von Produktionskunden Rechnung. Zusammen mit der seit 1988 bestehenden SÜSS-Firma in Yokohama, Japan werden die wichtigen Wachstumsmärkte im asiatischen Markt heute direkt bedient.

Im Sommer 2002 gab die SÜSS MicroTec-Tochter Image Technology bekannt, dass die speziellen 9- bzw. 14-Zoll Photomaschinen künftig neben Palo Alto auch in Taiwan produziert werden. Photomaschinen werden für die Lithografie mit Hilfe von Mask Alignern bei 200mm- und 300mm-Anwendungen verwendet. Die „Masken“ sind chrombeschichtete Glasplatten, in denen das mikroskopische Bild der elektrischen Schaltkreise eingearbeitet ist. Image Technology, Inc. aus Palo Alto, Kalifornien stellt diese Photomaschinen auf Basis der von Kunden zur Verfügung gestellten CAD-Daten her. Aufgrund von Designwechsel oder Verschleiß müssen Photomaschinen von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden; sie gelten deshalb als Schlüsselemente bei jeder Advanced Packaging-Applikation mit Mask Alignern. Der direkte Photomaschinen-Service vor Ort im derzeit wichtigsten asiatischen Markt garantiert Kunden, ihren Produktionszyklus ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten – entscheidend im Hinblick auf Kosten- und Zeitmanagement. Mit der Optimierung des Services für die Produktlinien Mask Aligner und Spin Coater und mit dem zusätzlichen Photomaschinen-Service, baut SÜSS MicroTec seine strategische Positionierung in Asien weiter aus.

Cashposition deutlich gestärkt

Die Kapitalerhöhung zu Beginn des vergangenen Geschäftsjahres stärkte die finanzielle Position von SÜSS MicroTec nachhaltig. Am 16. Januar 2002 wurden aus genehmigten Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung 1.130.000 nennwertlose Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Beim damaligen Kurswert von 30,50 Euro erzielte SÜSS MicroTec einen Mittelzufluss in Höhe von rund 33 Millionen Euro. Das neue Kapital wurde fast vollständig zur Schuldentilgung verwendet;



ein geringer Teil entfiel auf die ebenfalls noch im Januar 2002 erfolgte Akquisition der Vermögensgegenstände von B.L.E. Laboratory Equipment GmbH. Durch die Kapitalerhöhung sowie durch den positiven Cash Flow (auf das gesamte Geschäftsjahr bezogen) belief sich der Cash-Bestand von SÜSS MicroTec zum Stichtag 31. Dezember 2002 auf 13,4 Millionen Euro netto (2001: -22,1 Millionen Euro).

Produktportfolio gezielt ausgebaut

Am 17. Januar 2002 übernahm SÜSS MicroTec die Vermögensgegenstände – inklusive bestehender Aufträge – der B.L.E. Laboratory Equipment GmbH, die sich auf manuelle Spin Coater/Developer sowie auf ein neues Verfahren zum sogenannten Wafer Mounting spezialisiert hat. Mit diesem Zukauf konnte SÜSS MicroTec die Produktlinie der Spin Coater/ Developer gezielt ausbauen, die heute von modernsten manuellen Laborgeräten bis zu neuen, vollautomatisierten Systemlösungen im 300mm-Bereich reicht. Zu den einzigartigen und patentierten Entwicklungen der B.L.E. gehört auch das Wafer Mounting System „Fixxon“, das für die Herstellung extrem dünner Siliziumscheiben oder Verbindungshalbleiter eingesetzt wird. Diese neue Technologie ist wichtiger Bestandteil im Herstellungsprozess von Endprodukten wie modernen leistungsstärkeren Chip-Karten oder den zukünftig eingesetzten elektronischen Etiketten.

Vorstandsbereich neu strukturiert

SÜSS MicroTec strukturierte 2002 seinen Vorstandsbereich neu. Damit verbunden war die Neubesetzung und Straffung der Vorstandsebene. Seit April 2002 ist Stephan Schulak neuer Finanzvorstand (CFO) von SÜSS MicroTec und verantwortet in dieser Funktion die Bereiche Finanzen, Controlling, Bilanzierung und IT. Stephan Schulak, gelernter Kaufmann und diplomierter Betriebswirt, hat über 12 Jahre Berufserfahrung im

Finanz- und Rechnungswesen. Nach langjähriger Tätigkeit als Controller und Konzernrevisor bei der Wacker-Chemie-Gruppe, wechselte er im November 2000 als Beteiligungscontroller zur SÜSS MicroTec AG. Anschließend leitete er das Konzerncontrolling von SÜSS MicroTec.

Im Rahmen der Umstrukturierung ist der bisherige Vorstand Operations (COO), Claus Lichtenberg, zum 31. Oktober 2002 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Claus Lichtenberg hatte einen 3-Jahresvertrag bei SÜSS MicroTec. Das Vorstandsteam Dr. Franz Richter (Vorstandsvorsitzender) und Stephan Schulak (Finanzvorstand) hat die im Wesentlichen von Claus Lichtenberg vertretenen Bereiche Produktion und IT übernommen.

Bestnoten bei Kundenbefragung erreicht

Bei der jährlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit – durchgeführt vom auf die Halbleiterbranche spezialisierten Marktforschungsinstitut VLSI-Research – erzielte SÜSS MicroTec im Geschäftsjahr 2002 erstmals in gleich vier Kategorien Spitzenplätze unter den ersten 10 Herstellern: Den 1. Platz in der Kategorie „Test & Material Handling Equipment“; Rang 2 bei den „Small Suppliers of Wafer Processing Equipment“ und mit dem 6. Platz zum ersten Mal im Bereich „Assembly Equipment“ vertreten. In der neuen Kategorie „Focused Suppliers of Chip Making Equipment“ belegte SÜSS MicroTec AG den 7. Platz.

Nach Auswertung von VLSI Research ist SÜSS MicroTec das erste Unternehmen unter den Halbleiterzulieferern überhaupt, das sich bei der Kundenbefragung in gleich vier von insgesamt 13 Kategorien unter den „Top Ten“ behauptete. Insgesamt wertete VLSI Research für die Platzierungen des „10 Best Annual Customer Satisfaction Survey on Chip Making Equipment Suppliers“ rund 5.400 Fragebögen aus, die Entscheidungsträger in Halbleiterunternehmen ausfüllten.

2. MÄRKTE



Mit Qualität und Innovationen in Wachstumsmärkte

Schon 1963 wurde der erste Mask Aligner von SÜSS MicroTec auf den Markt gebracht. Inzwischen sind aus den anfänglich sehr einfachen Geräten hochkomplexe Produktionsanlagen geworden. Neben verschiedenen Funktionen die eine moderne Produktionsumgebung fordert – etwa die Kommunikation mit dem Zentralrechner der Halbleiterfabrik – sind heute auch zusätzliche Prozessschritte in die Maschinen integriert. So vereint der „LithoPack 300“ etwa neben dem Mask Aligner auch die beiden vor- und nachgelagerten Prozessschritte des Spin Coater und Developer in einer Maschine. SÜSS MicroTec bietet heute insgesamt fünf Produktlinien an, die folgende Prozessschritte abdecken:

- die Photostrukturierung (Mask Aligner),
- das Beschichten und Entwickeln von photoempfindlichen Materialien (Spin Coater und Developer),
- die Mikromontage von einzelnen Bauteilen (Device Bonder),
- die gleichzeitige Mikromontage von zahlreichen Bauteilen im Waferformat (Substrat Bonder) sowie
- das Testen von elektronischen Bauteilen auf dem Wafer (Testsysteme).

Weltweit sind mittlerweile über 7.000 Maschinen von SÜSS MicroTec bei Kunden installiert – so bei allen großen Halbleiterherstellern wie beispielsweise Intel, Infineon, Samsung, Casio oder auch Epcos und Bosch. In den gesamten Anwendungen der Massenproduktion ist neben höchster Präzision und Zuverlässigkeit eine hervorragende Wirtschaftlichkeit des Equipments gefragt. In der Halbleiterindustrie wird diese Wirtschaftlichkeit mit Hilfe der sogenannten „Cost of Ownership“ (CoO) gemessen. Sie berücksichtigt neben den Anschaffungskosten und den Kosten für die Reinraumfläche auch Betriebsverbrauchs- und Wartungskosten. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil der funktionsfähigen Mikrochips angegeben. Mit jeder falschen Verarbeitung eines Chips auf dem Wafer durch einen Fehler in der Maschine verlieren auch alle

vorhergehenden Prozessschritte für diesen Chip ihren Wert. Deshalb beeinträchtigen besonders am Ende der Prozesskette, im sogenannten „Backend“, Fehlerbeiträge der Produktionsmaschine, die Ausbeute der guten Chips auf dem Wafer und damit die Cost of Ownership erheblich. SÜSS MicroTec-Produkte werden mit dem Ziel einer überlegenen Cost of Ownership gegenüber den Wettbewerbsgeräten entwickelt. Höchste Standards in CoO und Technologie sichern SÜSS MicroTec so nachhaltig eine führende Position in den Märkten der Mikrotechnologie – auch in Krisenzeiten wie 2002.

Nachfolgend werden die wichtigsten Märkte von SÜSS MicroTec mit ihrer Technologie, Funktion und ihrem Potenzial beschrieben. Der Fokus liegt dabei auf den beiden Hauptmärkten Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik.

Advanced Packaging – Neue Verbindungstechnik für Halbleiterbausteine

Advanced Packaging ermöglicht eine neue Art der Gehäuse-technik für Halbleiterbausteine. Sie bietet im Vergleich zur konventionellen Gehäusetechnik eine deutlich verbesserte Integrationsdichte und Leistungsfähigkeit bei hohen Signalübertragungsraten. Advanced Packaging wird so die bisher verwendete Verbindungstechnik für viele neue Chipanwendungen mittelfristig ablösen. Diese „traditionelle“ Verbindungstechnik lässt sich beim Blick in ein PC-Gehäuse nachvollziehen: Der Chip wird in ein Kunststoffgehäuse gegossen, aus dem kleine „Metallfüße“ an den äußeren Rändern herausragen. Die nicht sichtbaren, internen elektrischen Verbindungen müssen so organisiert sein, dass der Chip optimal mit den oft über 1.000 äußeren Anschlüssen verbunden wird. Diese Verbindungen werden mit Hilfe sehr vieler und sehr kleiner Drähte erstellt („Wire Bonding“). Besonders bei Anwendungen mit hohen Übertragungsraten stößt das Wire Bonding aber mittlerweile immer häufiger an seine Leistungsgrenze. Darüber hinaus treiben

Belichtung für die Zukunft

Photolithographie ist ein Standardverfahren in der Halbleiterfertigung und einer der wesentlichen technischen Fertigungsschritte im Advanced Packaging-Verfahren. Es wird angewendet, nachdem eine photoempfindliche Lackschicht mit möglichst gleichmäßiger Schichtdicke (eine zehn Mikrometer) auf die Waferoberfläche aufgebracht wurde. Der Photolack wird nun mit ultravioletem Licht durch eine teilweise transparente Photomaske hindurch belichtet und überträgt dabei die auf der Photomaske vorgegebene,

mikroskopisch kleine Vorlage der Bumps auf den Wafer. Die Mask Aligner von SÜSS MicroTec sind auf die Belichtung der gesamten Waferoberfläche in einem Schritt ausgelegt. Dadurch wird ein bis zu 3-fach höheren Durchsatz als bei Konkurrenzverfahren erreicht, der schrittweisen Belichtung mit einem Stepper. SÜSS MicroTec-Mask Aligner zeichnen sich durch äußerste Präzision bei der Übertragung der Strukturen von der Photomaske auf den Wafer und größte Zuverlässigkeit im Produktionsbetrieb aus. Gerade in sogenannten Backend, der elektrischen Verbindung der fertigen Mikrochips, wirken sich

Fehler besonders dramatisch aus: Hier geht mit jedem Fehlereintrag durch eine Produktionsmaschine nicht nur der jeweilige Prozessschritt, sondern der gesamte Aufwand bei der Chipherstellung im Frontend verloren. Dieser Aufwand ist beträchtlich, weil der Wafer bereits mehrere Wochen eine Vielzahl verschiedener Prozessen durchlaufen hat und beispielsweise einen Produktionswert von bereits bis zu 20.000 US-Dollar hat. Mit ihrer hohen Zuverlässigkeit und Präzision gehören die SÜSS MicroTec-Mask Aligner deshalb zu den bevorzugten Maschinen für die Equipmentsauswahl für das Advanced Packaging.

immer kleinere Strukturen mit steigender Funktionalität die Anzahl der Anschlüsse pro Chip deutlich in die Höhe – und limitieren das seriell arbeitende Wire Bonding zusätzlich.

Gefragt ist also eine Verpackungstechnologie, die nicht nur kleinste Strukturen mit größter Funktionalität gewährleistet, sondern auch kostengünstig herzustellen ist. Die Lösung ist das sogenannte Advanced Packaging-Verfahren. Es gilt als die zukunftsweisende Verpackungstechnologie für alle Chipgenerationen in der Halbleiterbranche. Die Vorteile:

- Mikroskopisch kleine Lotkugeln – sogenannte „Bumps“ mit einem Durchmesser von etwa 30 - 80 Mikrometern – werden gitterförmig über die gesamte Chipfläche verteilt. Die Nutzung der gesamten Chips als Anschlußfläche erhöht die Anschlussdichte deutlich.
- Die Größe des fertigen Chipbausteins reduziert sich auf die Fläche des Chips; bei herkömmlich verpackten ICs ist die Grundfläche des Bauteils bis zu zehnfach größer als die Chipfläche.
- Alle Prozessschritte zur Herstellung der Bumps finden auf dem Wafer statt; die Chips werden anschlussfertig vom Wafer geschnitten. Das bringt im Gegensatz zur konventionellen Verbindung eine deutliche Kostenersparnis.

Im Alltag nutzen wir mittlerweile verschiedenste Produkte mit dieser technisch ausgefeilten Verbindungstechnik. Im Bereich Informationstechnologie sind es immer kleinere, leistungsfähigere PCs, Notebooks, Palm Tops oder Organizer; in der Telekommunikation fortschrittliche Handys und bei technischen Geräten für den Hausgebrauch zeigen DVD-Player, Digitalkameras, Flachbildschirme oder Uhren eine neue funktionale Vielfalt. Dabei lassen die aktuell präsenten Produkte erst den Anfang künftiger technologischer Möglichkeiten erkennen. Denn bisher werden erst wenige Prozent aller Chips mit dem Advanced Packaging-Verfahren gefertigt. Dieser Anteil soll in den nächsten Jahren auf über 15% wachsen.

EQUIPMENT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Mit der Einführung von Advanced Packaging sichern sich Halbleiterunternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit; sie festigen ihre Marktposition oder bauen diese weiter aus. Deshalb fanden auch im Krisenjahr 2002 Investitionen in diese innovative Technologie statt – allerdings mit entsprechend reduziertem Volumen. Viele Unternehmen haben die Technologie des Advanced Packagings eingeführt, erstes Equipment installiert bzw. kleinere Produktionskapazitäten aufgebaut. So erhielt SÜSS MicroTec u.a. wichtige Aufträge von Firmen wie AMCOR, ASE oder SPIL, die als weltweit führende Dienstleister (Foundries) das Packaging von Wafern für große Halbleiterunternehmen durchführen. Entscheidende Kriterien für die Equipment-Wahl sind dabei neben höchster technischer Qualität, niedrigere Anschaffungskosten und hohe Produktivität – so wie es SÜSS MicroTec im Vergleich zum Wettbewerb bietet. Die Kosten für die im Advanced Packaging-Prozess wichtigen vollautomatischen 300mm-Lithografie Geräte (Mask Aligner) liegen im Vergleich zum Wettbewerb je nach Anwendungsfall bis zu 60% tiefer. Das sind Vorteile, die sich langfristig im Marktanteil widerspiegeln werden.

Das laufende Geschäftsjahr 2003 werden die Halbleiterunternehmen für den Ausbau ihrer Advanced Packaging-Kapazitäten nutzen. Der Umfang der Investitionen bleibt dabei eng an die Branchensituation gekoppelt und findet im größeren Umfang erst bei Einsetzen des zyklischen Aufschwungs statt.

Mikrosystemtechnik – Mikrowelten auf Wachstumskurs

„Mikrowelten“ sind täglich präsent und doch für uns mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Kein Wunder: Entspricht doch ein Mikrometer einem Millionstel Meter – oder einem Tausendstel Millimeter. Mikrosysteme verfügen über eine außerordentliche Leistungsfähigkeit und Vielfalt. Dabei werden zahlreiche Funktionen auf engstem Raum gebündelt und integriert. Diese Mikrosysteme übernehmen in unserem Makro-Alltag oft einzigartige Aufgaben – mit teilweise deutlichen Vorteilen im Vergleich zu konventionellen technischen Produkten und Anwendungen. Neben der Funktionsvielfalt sind das:

- deutlich weniger Masse und geringerer Energieverbrauch,
- eine stark verbesserte Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit,
- Integration von elektronischen, mechanischen, optischen und vielen anderen Funktionen in einem System,
- Kombinationsmöglichkeit mit organischen Materialien.

Die Mikrosystemtechnik (MST; oder vor allem in USA: MEMS, für Micro Electro Mechanical Systems) zeichnet sich durch eine enorme Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten aus. In nahezu allen technischen Bereichen finden sich heute Mikrosysteme. Beispiele für Innovationen in diesem Bereich sind der Abtastkopf eines CD-Spielers, die Druckköpfe bei Tintenstrahldruckern, Puls- und Sauerstoff-Sensoren, optische Sensoren in Digitalkameras oder Antiblockiersysteme in Fahrzeugen. Die Beispiele verdeutlichen: Mikrosystemtechniken können in den verschiedensten Bereichen und Branchen eingesetzt werden. Viele Mikrosysteme sind bereits erfolgreich im Markt etabliert – eine große Anzahl wird gerade erst erforscht.

Aktuelle Studien unterstreichen die wachsende Bedeutung der Mikrosystemtechnik. So sagen die Experten des Marktforschungsinstituts NEXUS (Network of Excellence in Multifunctional Microsystems) der Mikrosystemtechnik jährliche welt-

weite Wachstumsraten von rund 20 Prozent voraus. Im Jahr 2005 soll das weltweite Marktvolumen bereits bei knapp 70 Milliarden US-Dollar liegen – im Geschäftsjahr 2002 belief es sich noch auf 38 Milliarden US-Dollar (NEXUS, Februar 2002). Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete für Mikrosysteme gilt dieser Markt im Vergleich zur Halbleiterindustrie als weniger zyklisch und als relativ resistent gegenüber möglichen Krisen der einzelnen Branchen. In allen Wachstumsbranchen wie der Automobilindustrie, Telekommunikation, Umweltanalyse oder bei Haushalts-Applikationen nimmt der Einsatz von „Mikrowelten“ immer weiter zu. Insbesondere den Branchen Computer- und Medizintechnik wird weltweites starkes Wachstum prognostiziert. So sind in der Humanmedizin durch den Einsatz von Mikrosystemen neue, „sanftere“ medizinische Anwendungen, etwa bei Puls- und Sauerstoffsensoren, Diagnostik oder der Medikation denkbar. Unterstützt wird der Trend zur sanfteren Medizin durch fortschreitende Entwicklungen neuer, hochpräziser Dosiersysteme bei der Medikamentenverabreichung oder durch die weitere Miniaturisierung bei Implantaten, wie etwa Herzschrittmachern.

INNOVATIONEN FÜR MIKROSTRUKTUREN

Für immer präzisere, komplexere und leistungsfähigere Mikrosysteme sind sehr exakte Fertigungsverfahren von entscheidender Bedeutung. Schlüsselprozess bei der Herstellung von Mikrosystemen ist heute – wie schon beim Advanced Packaging – die Photolithografie. Der Mask Aligner von SÜSS MicroTec gehört deshalb bei vielen MST-Herstellern zum Standard-Equipment und hat einen Marktanteil von geschätzten 60%. Neben den Mask Alignern werden auch alle anderen SÜSS MicroTec-Produkte in den MST-Applikationen eingesetzt: Spin Coater/Developer, Testsysteme, Device Bonder sowie Substrat Bonder. Damit hat SÜSS MicroTec im Vergleich zu allen Wettbewerbern das mit Abstand umfassendste Angebot für Hersteller von MST-Bauteilen. Noch überwiegt heute der Einsatz manueller und halbautomatischer Maschinen, die



Autos mit System

Das Auto hat sich in den letzten Jahrzehnten vom „fahrbaren Untersatz“ zum technologisch ausgefeilten Mobil entwickelt – in Hinblick auf Sicherheit, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Bei dieser Entwicklung spielten Mikrosysteme eine entscheidende Rolle. Im laufenden Jahr werden Mikrosysteme laut NEXUS-Studie bereits rund 20 Prozent vom Preis eines Neuwagens ausmachen (1999: rund 15 Prozent).

Ob beim Antiblockiersystem, Motormanagement, Navigationssystem oder bei Aufprallsensoren – immer treten extrem leistungsfähige Mikrosysteme in Aktion, die schnell und äußerst präzise die jeweilige Extremsituation meistern. Aufprallsensoren etwa erkennen wie

rasch sich je nach Geschwindigkeit des Autos ein

Airbag entfalten muß. In der Regel sind das nur wenige Tausendstel Sekunden. Höchste Zuverlässigkeit der Systeme ist deshalb gefordert – aber auch

ihre preisgünstige und massenhafte Herstellung. Denn heute profitieren bereits alle Wagenklassen vom technologischen Luxus. Wichtiges Kriterium für Autozulieferer beim Kauf vom technischen MST-Equipment ist

deshalb die Cost of Ownership – mit zunehmender

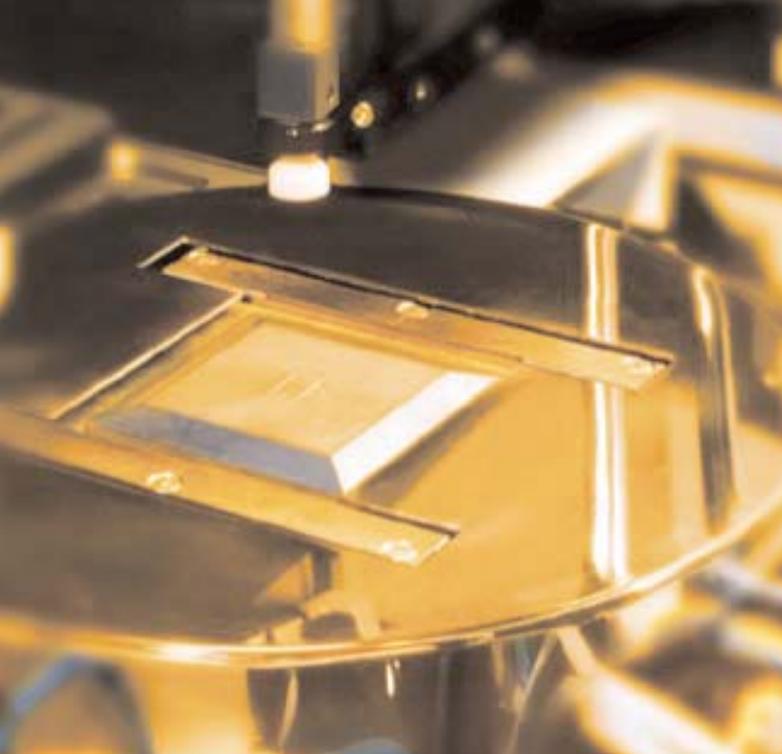
Bedeutung: MST-Applikationen im Automobilbereich werden weiter verbessert, noch vielfältiger und sind

für wesentliche Fortschritte in der Automobil-

technik auch künftig entscheidend.

Forschungsinstitute, Universitäten oder Start-up-Unternehmen sowie Kunden insbesondere für die Produktion bei kleinem Volumen nutzen. Eine geringere Anzahl machen derzeit noch die vollautomatischen Produktionsgeräte für die Massenherstellung von Mikrosystemen – etwa für Auto- oder Unterhaltungselektronik – aus. Der Marktanteil von SÜSS MicroTec-Equipment für Mikrosystemtechnik betrug Ende 2002 rund 35% – Tendenz steigend.

Im Jahr 2003 kündigt sich bereits eine neue Dimension der „Mikrowelten“ an: Auf Basis der technologischen Erfahrungen aus der Mikrosystemtechnik entwickeln sich erste Ansätze zur Herstellung von Nanotechnologien – mit Strukturen die nochmals um bis zu Tausendfach verkleinert sind und den Maßstab von einzelnen Atomlagen erreichen. SÜSS MicroTec bietet als eines der ersten Unternehmen bereit heute eine kommerzielle Technologie für diesen Zukunftsmarkt an: Das sogenannte Nanoimprinting (Prägetechnik) ist eine Art Verfeinerung des bisherigen Lithographieprozesses. Mit dem SÜSS MicroTec-Geräten Mask Aligner oder Device Bonder werden hierbei Strukturen in die photoempfindliche Lack- oder Polymer-schicht eingedrückt – ähnlich wie mit einem Stempel. Durch die Verfeinerung dieser Technologie konnten im Labormaßstab bereits Strukturen in der Größenordnung von wenigen 10 Nanometern hergestellt werden – und damit; erheblich kleinere Strukturen als bei den heute gängigen Lithographieverfahren des Front Ends der Halbleiterherstellung. Forschungsinstitute und Universitäten setzten die Nanoimprinter von SÜSS MicroTec bereits zur Erprobung ein – und auch Unternehmen haben schon Interesse an der neuen SÜSS MicroTec-Technologie signalisiert.



Verbindungshalbleiter – Garanten für Informationsdichte

Verbindungshalbleiter sind wissenschaftlich betrachtet eine bestimmte Klasse von Halbleitermaterialien, die sich aus Elementen der dritten und fünften Hauptgruppe des Periodensystems zusammensetzen. Wesentliche Elemente dieser Gruppen sind Gallium und Arsen (zusammengesetzt: Galliumarsenid (GaAs)) oder Indium und Phosphor (zusammengesetzt: Indiumphosphid (InP)). Diese Materialien zeichnen sich durch besonders hohe Elektronenbeweglichkeit aus. Für die Praxis bedeutet das: Verbindungshalbleiter können elektrische Signale mit sehr hoher Geschwindigkeit übertragen und verarbeiten; eignen sich so besonders für hochfrequente Anwendungen. Darüber hinaus vereinen Verbindungshalbleiter zahlreiche interessante optoelektronische Eigenschaften, die eine Beeinflussung der Elektronenbeweglichkeit durch Lichteinfall und umgekehrt ermöglichen. Diese Eigenschaften lassen sich bereits heute technisch in vielfältiger Weise nutzen, z.B. zur Herstellung optischer Sensoren oder Leuchtdioden. Das Einsatzgebiet von Verbindungshalbleitern erweitert sich ständig.

Die größten Anwendungsfelder finden sich heute in:

- der optischen Signalübertragung (Datenaustausch über Glasfaser);
- der drahtlosen Kommunikation (hochfrequente Anwendungen);
- den optischen Elementen für den Consumerbereich (Lichterzeugung durch Leuchtdioden).

Im Bereich drahtlose Kommunikation sind nur durch den Einsatz von Verbindungshalbleitern – z.B. in Form sogenannter Oberflächenwellenfilter (oder Surface Acoustic Wave (SAW) Filter) – hochfrequente Anwendungen von 40 Gigahertz und mehr möglich. Die Verwendung dieser hochfrequenten Bauteile kann die Zahl der Sprachkanäle in einem Netz und damit die Übertragungskapazität des Netzes deutlich erhöhen.

Ein weiterer Wachstumsbereich sind „Wireless LANs“ und „Bluetooth“. Beides sind drahtlose Verbindungen zwischen verschiedenen Geräten der Kommunikation. Bluetooth kann Geräte, die sich im Abstand von 1 bis 2 Metern zueinander befinden, kabellos miteinander verbinden. Beispiele sind hier die kabellosen Verbindungen zwischen PC und Maus, PC und Tastatur, Mobiltelefon und Kopfhörer. Bis 2004 werden rund 50% der Handys weltweit mit Bluetooth ausgestattet sein.

Die Wireless LANs – oder drahtlose lokale Netzwerke – stellen kabellose Verbindungen zwischen Computern innerhalb eines typischen Radius von einigen 10 Metern her. Solche Wireless LANs werden an öffentlichen Plätzen, Hotels, Bahnhöfen oder Flughäfen eingerichtet. Notebooknutzer können sich dann kabellos in ein Netzwerk einwählen und jederzeit Internet oder ihre E-Mail Office nutzen.

Im Bereich optische Elemente ist besonders die Entwicklung der Leuchtdioden (LEDs – Light Emitting Diodes) von Interesse. Die Lichtausbeute in LEDs ist bereits deutlich höher als in herkömmlichen Glühlampen oder Leuchtstoffröhren – und wird kontinuierlich weiter gesteigert. Neben dem Automobil als klassischem und erstem LED-Anwendungsbereich – etwa bei der Display-Beleuchtung oder Bremslichtern – kommen LEDs künftig auch in Verkehrsampeln und in der allgemeinen Beleuchtung zum Einsatz. Bis 2004 soll die Branche für optische Elemente rund 30% wachsen. LEDs haben daran einen großen Anteil.

LITHOGRAPHIE FÜR SENSIBLE VERBINDUNGEN

Die Herstellung von Verbindungshalbleitern ist im Vergleich zum Silizium als dem gängigsten Halbleitermaterial sehr viel schwieriger und teurer. Das heute gängige Waferformat beim GaAs ist 150mm; bei Silizium 300mm. Weil aber die typischen Chipgrößen bei den Verbindungshalbleitern (typisch: mm²) deutlich kleiner sind als bei den Siliziumanwendungen

(typisch: cm²), geht der Trend Schritt für Schritt auch bei den Verbindungshalbleitern zu größeren Waferformaten.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Anforderungen gibt es auch bei der Auswahl des Fertigungs-Equipments deutliche Unterschiede zwischen Silizium und Verbindungshalbleitern. Für die Photolithografie, auch hier der bedeutendste Prozessschritt, werden häufig Mask Aligner als Kontaktbelichter eingesetzt. Der Vorteil einer kostengünstigen Photolithografie beinhaltet dabei das Risiko von Fehlereinträgen bei der Kontaktlitographie. Einzelne Fehlereinträge relativieren sich hier jedoch und beeinträchtigen die prozentuale Ausbeute nur geringfügig. Denn: Aufgrund der geringen Abmessungen der Chips finden Tausende Chips auf einem Wafer Platz.

Eine neu entwickelte Technologie von SÜSS MicroTec verhindert nun auch den Nachteil von Fehlereinträgen: Bei der sogenannten Mask Pellicle Technology (MPT) wird die Maske mit einer extrem dünnen teflonähnlichen Schutzschicht überzogen und so von Photoresist-Anlagerungen während der Kontaktbelichtung geschützt. Dadurch reduziert sich die sonst übliche Maskenreinigung deutlich; die Lebensdauer der Photomaske wird deutlich verlängert. Mit diesem neuen Verfahren verbessert SÜSS MicroTec den Kostenvergleich zwischen Mask Alignern und anderen Lithographieverfahren weiter deutlich zu Gunsten der Mask Aligner.

Energiebündel LED

Für uns sind es einfach nur bestimmte Farben – für die Wissenschaft dagegen bestimmte Wellenlängen, welche die Farben erzeugen. Resultat aktueller Forschungen und Entwicklungen ist, dass LEDs nahezu ideale Lichtspender für unterschiedliche Farben sind. Der Vorteil: LEDs sind praktisch wartungsfrei. Bei gleicher Lichtleistung verbrauchen LEDs bis zu 50% weniger Energie als bisher übliche Glühlampen und haben darüber hinaus eine deutlich längere Lebensdauer. In vielen Bereichen der Innen- oder Außenbeleuchtung, können LEDs damit kostengünstig eingesetzt werden. So findet in den USA beispielsweise bereits die schrittweise Umrüstung von Verkehrsampeln auf LEDs statt. In Deutschland starteten hierfür 2001 erste Pilotprojekte. Prognosen zufolge werden mittelfristig alle Industrieländer weltweit LEDs in ihren Ampeln einsetzen. In der allgemeinen Beleuchtung – ob auf der Straße, im Haus oder in technischen Geräten – werden LEDs in einigen Jahren ebenfalls unsere Lichtspender sein. Diese Entwicklung wird das Wachstum im SÜSS MicroTec-Markt der Produktionsgeräte für Verbindungshalbleiter weiter vorantreiben.

Eiszeit für Sensoren

Die Funktionsfähigkeit von Chips oder Sensoren muss auch in Extremsituationen gewährleistet sein. Neben analytischen Testverfahren mit elektrischem Strom, Kraft, Druck oder Beschleunigung werden deshalb auch Hitze oder Kälte für „Belastungstests“ eingesetzt. Viele physikalische Effekte lassen sich nur bei sehr niedrigen Temperaturen – in der Nähe des absoluten Nullpunkts - bei minus 293 Grad messen.

Der spezielle und im Markt einzigartige Prober (SÜSS-PAC 150) kann Temperaturen von bis zu minus 250 Grad erzeugen. Er testet beispielsweise Infrarotsensoren, die für Satelliten verwendet werden. Diese speziellen Sensoren bleiben auch bei extremer Kälte und im Vakuum funktionsfähig. Gerade bei den hohen Anforderungen der Raumfahrt an die Zuverlässigkeit der Bauteile kommt Testverfahren eine besondere Rolle zu. Fallen Sensoren aus, kann es am Satelliten zu Fehlfunktionen kommen;

der Einsatz des Satelliten könnte im Extremfall gefährdet sein. Der SÜSS MicroTec-Prober testet den Wafer deshalb unter entsprechenden Einsatzbedingungen. Hierfür wird der Wafer mit den Sensoren im Hochvakuum auf minus 200 Grad heruntergekühlt und anschließend mit Hilfe von speziellen, kälte-unempfindlichen Nadeln elektrisch getestet. Dieses aufwendige Verfahren schließt mögliche Fehlerquellen aus und sichert die hochwertige Qualität der Sensoren.

Test & Measurement - Analyse für kleinste Strukturen

Test & Measurement ist ein besonderer Bereich der SÜSS MicroTec-Märkte. Denn es ist kein Produktionsmarkt, sondern ein hochspezialisierter Analysebereich. Bei Test & Measurement wird das elektrische Verhalten der Bauteile auf einem Chip von den ersten Forschungsversuchen bis zur Endproduktion kontrolliert. SÜSS MicroTec hat sich in diesem Bereich auf das analytische Testen von Strukturen spezialisiert – geht also mit seinem Test-Equipment den Fragen auf den Grund „wieso oder weshalb“ beispielsweise ein Chip nicht funktioniert. Die hierfür entwickelten SÜSS MicroTec-Analysegeräte sind die Prober. Seit 1970 ist SÜSS MicroTec in diesem Markt tätig und hat inzwischen eine ganze Produktpalette zum analytischen Testen von Mikrochips entwickelt. Die Produktlinie umfasst mittlerweile zehn manuelle, halb- oder vollautomatische Prober mit entsprechendem Zubehör. Sie werden für Fehleranalyse, Device- und Wafer-Charakterisierung, Zuverlässigkeits- und Funktionstests, im allgemeinen Halbleitermarkt sowie in der Hochfrequenztechnik eingesetzt. Dazu kommen die Nischen- und Wachstumsmärkte Optoelektronik und Mikrosystemtechnik. Durch Fokussierung auf diese Wachstumfelder hat sich SÜSS MicroTec in den meisten Anwendungsfeldern eine hervorragende Marktposition erarbeitet, mit einem Marktanteil zwischen 25 und 40 Prozent.

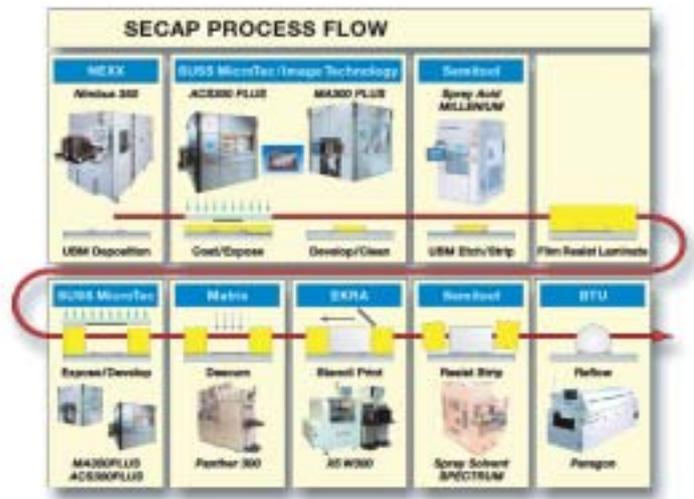
Der Fokus bei Testverfahren liegt in Überprüfung der Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Funktionsfähigkeit von Chip-Strukturen. Die Testverfahren selbst weichen je nach Produktionsmarkt teilweise stark voneinander ab. Je spezialisierter und weniger standardisiert ein Markt ist, desto individuellere Testverfahren sind gefordert. Die SÜSS MicroTec-Prüfsysteme werden diesen Anforderungen gerecht: Das Gerätekonzept für Prober ist dabei modular ausgelegt; die Prober werden kundenspezifisch ausgestattet und können jederzeit umgerüstet werden. Nur so werden die für Wachstumsmärkte benötigten

individuellen, effektiven und qualitativ hochwertigen Testverfahren möglich. Zum Beispiel können mit einem speziell entwickelten Prüfkopf (SÜSS MFI Probe) selbst kleinste Strukturen bis zu 0,18 Mikrometer getestet werden.

INDIVIDUALTESTS FÜR KLEINSTE STRUKTUREN

Innovationen bietet SÜSS MicroTec seit 2002 auch für Prüfverfahren in der Mikrosystemtechnik. Beispielsweise sollen die hier gefertigten Sensoren physikalische Zustände wie Druck, Beschleunigung oder Kraft messen. Denn ein rein elektrisches Testverfahren, wie in der Mikroelektronik üblich, lässt in diesem Fall nur bedingt eine Aussage über die Funktionsfähigkeit des Sensors zu. Bei dem sogenannten „on-wafer-testing“ für Mikrosysteme führen SÜSS MicroTec-Prober bereits während der Produktion der Mikrosysteme auf dem Wafer Testverfahren mit nicht elektrischen Signalen durch. Sie überprüfen in der Mikrosystemtechnik etwa unter Einleitung einer physikalischen Größe, wie Druck oder Kraft die Funktionsfähigkeit von Sensoren. Weil rund 60% der Gesamtkosten eines Mikrosystems im Packaging liegt, stellt das Testen und Aussortieren der funktionsfähigen Systeme sicher, dass nur diese den teureren Packaging-Schritt auch durchlaufen. SÜSS MicroTec-Equipment kann so die Produktion in der Mikrosystemtechnik straffen und Kosten für Kunden sparen. Für jeden Sensortyp gibt es aufgrund der Vielfalt in der Mikrosystemtechnik ein eigenes Prüfmodul. Viele dieser Module sind Sonder-Anfertigungen für den Kunden. Individualität und Flexibilität stehen auch bei künftigen Entwicklungen im Blickpunkt: Neue Probersysteme entwickelt SÜSS MicroTec in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden wie zum Beispiel die Fraunhofer Institute oder Firmen wie IBM oder Texas Instruments – und treibt damit insbesondere in den Nischenmärkten die Optimierung der Produktionsverfahren mit voran.

3. SECAP



Starker Partner für Advanced Packaging Kunden

Auf Initiative von SÜSS MicroTec gründete sich im Herbst 2000 das Semiconductor Equipment Consortium for Advanced Packaging (SECAP). Mitglieder von SECAP sind weltweit führende Anbieter für die Advanced Packaging-Technologie: BTU, Image Technology, Matrix Integrated Systems, NEXX Systems, Semitool, SÜSS MicroTec. Eine spezielle Funktion hat das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) als weiteres Mitglied. Es fungiert innerhalb des Konsortiums als Berater und technisches Bindeglied, ist Anwendungszentrum für die Integration der Prozessabläufe zwischen den verschiedenen Partnern und betreibt die SECAP-Fertigungslinie.

Ziel von SECAP ist, die Chiphersteller bei der Einführung von Advanced Packaging zu beraten und zu unterstützen – etwa bei der Entwicklung und Optimierung von Prozessausstattungen für die Umstellung auf die 300mm-Technologie. Dabei bleibt das Konsortium gemäß den SECAP-Statuten sämtlichen Packaging-Technologien gegenüber neutral und verfolgt nicht die Absicht, diese zu entwickeln oder zu vermarkten. SECAP soll Kunden ein wettbewerbsfreies Entwicklungs- und Testumfeld schaffen und ihnen eine neue, leistungsfähige Form der Partnerschaft bieten.

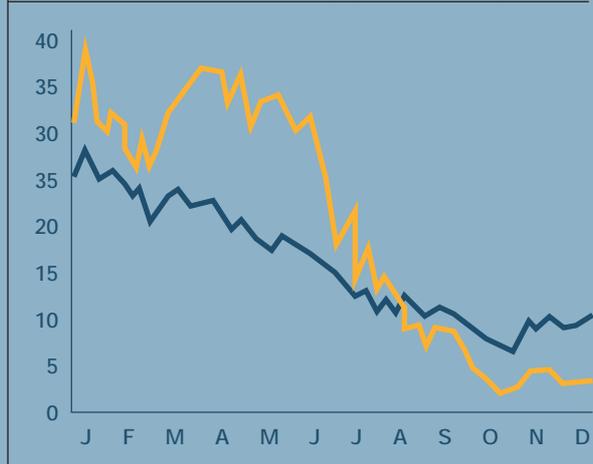
Im Juli 2002 setzte SECAP einen strategischen Meilenstein, der die Einführung von Advanced Packaging-Anwendungen weltweit vorantreibt: Das Konsortium wird in einem Joint Venture mit einem der weltweit führenden Entwickler und Anbieter von Advanced Packaging-Lösungen, Unitive Inc., USA, eine Produktionslinie für diese zukunftsweisende Technologie einrichten und betreiben. Die ab April 2003 bei der Unitive-Tochter Unitive Semiconductor Taiwan Corp. (UST) in Hsinchu, Taiwan, installierte Produktionslinie nutzt UST dann zur Einführung der 300mm-Technologie und zur anschließenden Massenproduktion. Bislang setzt Unitive (selbst kein SECAP-Mitglied) das

SECAP-Equipment für seine Produktionen im 200mm-Bereich ein. Zusätzlich steht die neue Produktionslinie im Rahmen eines Time Sharing Modells auch weiteren potenziellen SECAP-Kunden für Test- und Evaluierungszwecke zur Verfügung.

SECAP öffnet so die neue und zukünftig dominierende 300mm-Technologie erstmals der gesamten Chipbranche und kann in Kooperation mit Unitive die hohe Effektivität und Produktivität seiner Advanced Packaging-Technologie demonstrieren. Den Chipherstellern wird dadurch der Einstieg in Advanced Packaging spürbar erleichtert: Sie können die Prozessschritte vor Ort testen, auf ihre individuellen Produktionsbedürfnisse abstimmen sowie schneller und reibungsloser die Massenproduktion aufnehmen.

4. INVESTOR RELATIONS

Kursverlauf 2002 SÜSS MicroTec AG () vs. NEMAX 50 (-)



Aktie unter Druck

Die anhaltende Krise der Halbleitermärkte und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von SÜSS MicroTec beeinflussten den Kursverlauf unserer Aktie deutlich. Die SÜSS MicroTec-Aktie weist auf Jahressicht 2002 gegenüber dem NEMAX 50 und NEMAX Technology-Index eine deutlich schlechtere Performance auf. Insbesondere im 3. Quartal müssen wir starke Kursverluste hinnehmen. Neben der weltweit negativen Grundstimmung an den Kapitalmärkten sind weitere allgemeine und branchenspezifische Faktoren für den überwiegend schwachen Kursverlauf unserer Aktie maßgeblich:

- politische und wirtschaftliche Risikofaktoren wie Konjunkturlaute und Auswirkungen eines Irak-Krieges führen zur Verunsicherung bei Anlegern;
- weltweit führende Halbleiterhersteller reduzieren im Verlauf 2002 ihre Umsatzprognosen;
- klare Indikatoren für einen kommenden Aufschwung der Halbleiterbranche sind 2002 nicht auszumachen;
- Institutionelle Anleger verringern ihre Aktienbestände von Neuen Markt- bzw. Halbleiter-Werten; teilweise werden Neue Markt-Fonds von Banken komplett aufgelöst;
- Abstufungen durch Analysten verunsichern Anleger und führen zu Aktien-Verkäufen;
- Ungewissheit über die Zukunft des Neuen Marktes fördert die Zurückhaltung von neuen Investments.

Vorrangige Aufgabe und primäres Ziel in diesem schwierigem Marktumfeld ist es, die Investoren weiterhin so zeitnah und transparent wie möglich, über die aktuelle Geschäftsentwicklung von SÜSS MicroTec zu informieren. Hohe Priorität haben in diesem Zusammenhang Informationen über die Anpassung von Unternehmens- und Kostenstrukturen und über die weitere Positionierung von SÜSS MicroTec.

Der SÜSS MicroTec-Vorstand nutzte deshalb 2002 unter anderem Roadshows, Investoren- oder Telefonkonferenzen sowie

Einzelgespräche mit Investoren, Analysten und Pressevertretern, um den konstanten Informationsaustausch mit dem Kapitalmarkt zu gewährleisten, und um die Investoren-Kontakte weiter zu pflegen.

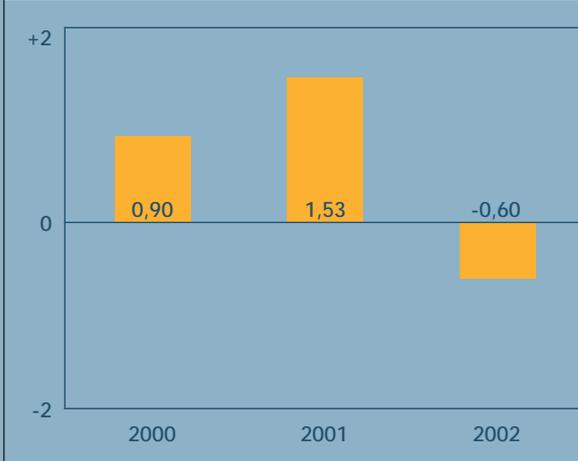
KAPITALMARKT MIT NEUER STRUKTUR

Lange wurde über die Zukunft des Neuen Marktes diskutiert und spekuliert. Am 16. Oktober 2002 gab die Deutsche Börse den Beschluss zur Neustrukturierung des Aktienmarktes bekannt: Ab 2003 sollen sich Unternehmen ausschließlich in den Segmenten „Prime Standard“ oder „General Standard“ handeln lassen. Alle bisher bekannten Segmente entfallen nach einer entsprechenden Übergangsfrist. Damit wird der Neue Markt nach abgeschlossener Einführung der Neusegmentierung ebenfalls aufgelöst.

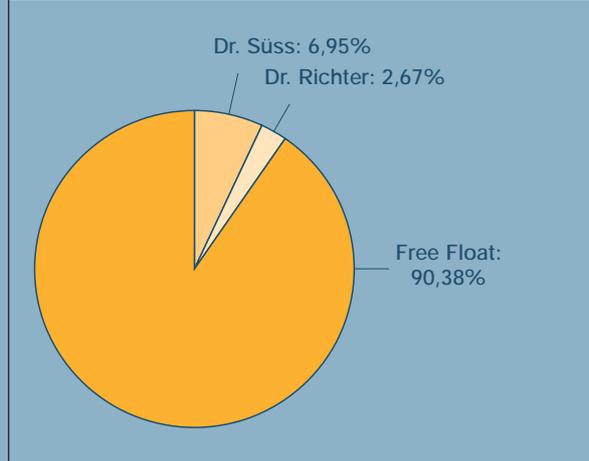
Der wesentliche Unterschied zwischen den neuen Segmenten: Unternehmen, die sich im „Prime Standard“ handeln lassen, verpflichten sich zu hohen, internationalen Transparenzstandards – wie etwa Quartalsberichten oder Ad hoc-Mitteilungen in deutscher/ englischer Sprache. Firmen im „General Standard“ richten sich dagegen auf die nationalen Kapitalmärkte aus – mit deutlich geringeren Transparenz- und Berichtsanforderungen.

SÜSS MicroTec erfüllt bereits seit dem Börsengang die strikten Anforderungen bezüglich größtmöglicher Transparenz, kontinuierlicher Berichterstattung und internationaler Rechnungslegung. Hinzu kommt der enge Kontakt mit internationalen Investoren. Ein Wechsel in den neuen „Prime Standard“ war deshalb für unser Unternehmen selbstverständlich. Bereits im Dezember stellten wir den Antrag für die Aufnahme in das neue Qualitätssegment; ebenfalls noch im Dezember erfolgte die Zulassung der Deutschen Börse zum Prime Standard. Darüber hinaus ist SÜSS MicroTec weiter im Auswahlindex NEMAX 50 gelistet und strebt eine Aufnahme in dem neuen Blue Chip-Index für Technologiewerte TecDAX an.

Ergebnis pro Aktie zum 31.12.2002 in Euro (unverwässert)



Aktionärsstruktur zum 31.12.2002 / Insgesamt 14.956.884 Aktien



MEHR TRANSPARENZ DURCH CORPORATE GOVERNANCE

Die Förderung von Unternehmenstransparenz ist auch eines der wesentlichen Stichworte für den Corporate Governance Kodex, der im Februar 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Deutsche Corporate Governance Kodex will und soll das Vertrauen der Öffentlichkeit (Anleger, Kunden, Mitarbeiter) in eine verantwortungsvolle und wertorientierte Unternehmensführung fördern – auch, was die Transparenz nach außen betrifft.

Die SÜSS MicroTec AG verpflichtet sich nachhaltig zu den Grundsätzen des Corporate Governance Kodex und wird die Prinzipien transparenter Unternehmensführung auch weiterhin fördern und forcieren. SÜSS MicroTec erfüllt die Empfehlungen des Corporate Governance-Katalogs bereits im Geschäftsjahr 2002 bis auf wenige Abweichungen und setzt darüber hinaus zahlreiche Anregungen um. Detaillierte Angaben hierzu finden Sie in unserer Entsprechenserklärung auf S. 20.

5. CORPORATE GOVERNANCE

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum deutschen Corporate Governance Kodex

Der „Deutsche Corporate Governance-Kodex“ beinhaltet national und international anerkannte Standards für eine faire und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die Standards unterteilen sich in:

- Vorschriften, die zwingend von deutschen, börsennotierten Unternehmen anzuwenden sind,
- Empfehlungen, nach denen gemäß § 161 des deutschen Aktiengesetzes jährlich eine Erklärung abzugeben ist und
- Anregungen, von denen Unternehmen ohne Offenlegung abweichen können.

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG verpflichten sich nachhaltig zu den Grundsätzen des Corporate Governance Kodex und fördern die Prinzipien transparenter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Die SÜSS MicroTec AG erfüllt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex bereits heute und auch in Zukunft bis auf wenige Punkte.

In folgenden Empfehlungen weicht die SÜSS MicroTec AG vom Deutschen Corporate Governance Kodex ab (Fassung vom November 2002):

Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen (Kodex Ziffer 3.8)

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt bei Abschluß einer Directors and Officers Liability Insurance (Haftpflichtversicherung), einen angemessenen Selbstbehalt für die Organe der AG zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Handeln aller geschäftsführenden Organe wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbezalts nicht zusätzlich gefördert. Die SÜSS MicroTec AG plant deshalb keine Vereinbarung eines organspezifischen Selbstbezalts.

Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern (Kodex Ziffer 5.4.5)
Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt eine feste Vergütung, die u.a. den Vorsitz in Ausschüssen sowie eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern berücksichtigt. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell ausschließlich eine feste Vergütung des Aufsichtsrates vor. Der Vorsitz in Ausschüssen wird dabei nicht zusätzlich berücksichtigt. Die SÜSS MicroTec AG möchte es bei dieser Regelung belassen und wird dies in der nächsten Hauptversammlung den Aktionären erläutern.

Kapitalmarktrelevante Informationen im Ausland
(Kodex Ziffer 6.5)

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt die unverzügliche Bekanntgabe von Informationen in Deutschland, die das Unternehmen aufgrund kapitalmarktrechtlicher Vorschriften im Ausland veröffentlicht. Auf die SÜSS MicroTec AG trifft die Empfehlung bezüglich der Veröffentlichung im Ausland derzeit nicht zu.

Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers
(Kodex Ziffer 7.2.1)

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers vor Unterbreitung des Wahlvorschlags für die entsprechende Prüfungsgesellschaft einzuholen. Die SÜSS MicroTec AG hat die Unabhängigkeitserklärung nachträglich eingeholt und damit der Kodex-Empfehlung bereits für das Geschäftsjahr 2002 entsprochen. Den Wahlvorschlag für den Abschlussprüfer unterbreitete SÜSS MicroTec auf der vergangenen Hauptversammlung und damit vor Veröffentlichung des geltenden Corporate Governance Kodex.

Garching, im Dezember 2002



Für den Vorstand
Dr. Franz Richter



Für den Aufsichtsrat
Dr. Winfried Süss

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die Unternehmensgruppe

Der SÜSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Marktnischen bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern, z.B. im Rahmen des SECAP-Konsortiums, Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Standorte der Gruppe

Deutschland	Asslar, Dresden, München, Vaihingen
USA	Waterbury VT, Palo Alto CA
Frankreich	St. Jeoire
GB	Wokingham
Japan	Yokohama

Vorausschauende Aussagen

Sämtliche im Lagebericht enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie in dem US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 festgelegt. Worte wie „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „rechnen mit“, „schätzen“, „sollen“, „sollten“, „können“, „werden“ und „planen“ sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf das Unternehmen sollen solche vorausschauenden Aussagen anzeigen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse zahlenmäßig von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden.

Unternehmensentwicklung und Marktlage im Jahr 2002

Während sich die Unternehmensgruppe in 2001 noch sehr gut von der allgemeinen Marktentwicklung in der Halbleiterindustrie abkoppeln konnte, schlug sich 2002 auch bei uns die Krise voll nieder. In der Konsequenz brach der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr erheblich auf 127,5 Mio. EURO (2001: 214,8 Mio. EURO) um 41% ein. Dazu trugen insbesondere die Umsatzrückgänge in den Regionen Nordamerika und Japan bei, in denen folglich auch ein wesentlicher Teil der Verluste anfiel. Beim Auftragseingang war bereits im 2. Halbjahr 2001 in allen Regionen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, so dass der Auftragsbestand zu Beginn des Jahres 2002 um 44% niedriger lag als zu Beginn 2001. Während des gesamten Jahres 2002 zeigte sich keinerlei Belebung bei den Auftragseingängen, die in den einzelnen Quartalen zwischen 21 und 30 Mio. EURO pendelten.

Deutlich erkennbar war die geringe Nachfrage nach Produktionsmaschinen, die unsere wesentlichen Umsatzträger darstellen. So waren sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz überwiegend auf manuelle Geräte zurückzuführen, die deutlich niedrigere mittlere Verkaufspreise aufweisen. Da die typischen Anwendungen für diese Geräte nicht im Produktionsumfeld liegen, folgt dieses Volumen nicht zwingend dem jeweiligen Zyklus. Da sich eine weitere Abschwächung der neu eingegangenen Aufträge nicht abzeichnete gingen wir davon aus, dass diese Auftragsvolumina das untere Ende des Unternehmenspotenzials darstellten. Auf Basis dieser Annahme wurden Mitte des Jahres sanfte und im 4. Quartal, bei weiter überwiegend ausbleibender Nachfrage nach Produktionsmaschinen, drastische Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen, um den Bestand des Konzerns zu sichern.

Die Halbleiterindustrie konnte sich in 2002 im Vergleich zu 2001 nicht erholen:

- Der DRAM-Markt leidet weiter unter den niedrigen Verkaufspreisen und Überkapazitäten, wie die Geschäftsentwicklung von marktführenden Unternehmen, z.B. Micron, Infineon oder Hynix, zeigt.
- Die Prozessorhersteller, vor allem Intel und AMD, konnten in 2002 keine signifikante Umsatzverbesserung erzielen. Antizipierte saisonale Zuwächse, z.B. das back-to-school business im PC-Bereich, fanden 2002 kaum statt.

- Die Telekommunikationsindustrie befindet sich immer noch in einem Prozess der Marktberreinigung und Restrukturierung, nachdem die hohen Erwartungen in diesem Segment von der Realität spürbar eingeholt wurden.

Die weltwirtschaftliche Abschwächung wirkte als Negativverstärker:

- Die wesentlichen Industrieländer zeigten in 2002 eine allgemeine konjunkturelle Verschlechterung.
- Die Konsumbereitschaft ging aufgrund der Zukunftsangst hinsichtlich des eigenen Arbeitsplatzes, aber auch aufgrund von Ängsten vor Terror und Krieg zurück.

Ein weiterer wichtiger Parameter für unsere Geschäftsentwicklung, das Wechselkursverhältnis zwischen dem EURO und dem US-Dollar, entwickelte sich zu unseren Ungunsten, da wir auch bei den Umsätzen in Nordamerika einen erheblichen Anteil der Wertschöpfung im EURO-Währungsraum generieren.

Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2001 zeigte sich das Jahr 2002 insgesamt als sehr harter Einschnitt, da die erhoffte und von verschiedenen Stellen erwartete Erholung der Märkte auch im 2. Halbjahr vollständig ausblieb. Verschiedene interne (Angebotsaktivität, Sales Forecasts) wie externe (Auslastungsquoten, Forecasts und Research-Berichte der Fachverbände) Indikatoren ließen für das 2. Halbjahr 2002 eine Belebung erwarten.

Wir hielten in dieser Erwartung die Struktur des Unternehmens zu Beginn des Jahres zunächst aufrecht, um bei dieser Belebung entsprechend die Umsatzpotenziale in dieser Belebung auch realisieren zu können. Da jedoch die oben genannten Indikatoren nicht zu der erwarteten Belebung führten, reagierten wir dementsprechend in einer ersten Stufe mit Personalabbaumaßnahmen im Sommer 2002.

Auf Basis der verhaltenen Entwicklung der Auftragseingänge im 3. Quartal musste dann in einer zweiten Stufe ein deutlich erhöhter Personalabbau eingeleitet werden, um auch eine mögliche schwache Geschäftsentwicklung im Jahr 2003 vor allem finanziell verkraften zu können.

Strategische Positionierung

Insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten kommt der

strategischen Positionierung eine besondere Bedeutung zu. Investitionsentscheidungen werden vorsichtiger getroffen und haben oft deswegen zukunftsorientierten Charakter, weil in diesen Phasen zwar keine Kapazitäts-, aber weiterhin – bei deutlich geringeren Stückzahlen – Technologiekäufe getätigt werden. Eben diese Technologiekäufe stellen aber die Kapazitätskäufe der Zukunft dar, die dann auch wieder Stück- und Umsatzvolumen darstellen.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Möglichkeiten konnten wir bei der Positionierung in unserem entscheidenden Zukunftsmarkt, dem Advanced Packaging, in 2002 wichtige Erfolge für uns verbuchen:

- Bei zwei Foundries in Asien konnten wir unsere 300mm-Lithographie umsatzwirksam installieren, wobei im 4. Quartal 2002 auch bereits erste Kapazitätskäufe zu verzeichnen waren.
- Bei einem namhaften Chiphersteller konnten wir 200mm-Lithographie erfolgreich einführen.
- Innerhalb des SECAP-Konsortiums wurde entschieden, mit der Firma Unitive gemeinsam eine komplette 300mm-Demonstrations- und Produktionslinie in Taiwan in 2003 im Rahmen eines Joint Venture zu installieren.
- Im DRAM-Bereich konnte unser 300mm-LithoPack, ein Clustertool mit Spin Coater und Mask Aligner, einen wichtigen Meilenstein in der Qualifizierung für die Fertigung erreichen.
- Unsere Kundenbasis im 200mm-Bereich ist weiterhin vorhanden. Wir erwarten bei der Migration auf 300mm aus dieser Kundenbasis eine bevorzugte Wahl von SÜSS MicroTec-Equipment.

Aufgrund dieser Erfolge erwarten wir, dass bei dem nächsten Aufschwung in der Halbleiterindustrie signifikante Umsätze sowohl im 200mm- als auch im 300mm-Bereich erzielt werden können, wobei wir insbesondere im Bereich der hochvolumigen Massenproduktion deutliche Wettbewerbsvorteile für unsere Maschinen sehen.

In Asien sehen wir uns organisatorisch zukunftsicher aufgestellt:

- Sowohl in Taiwan als auch in China waren wir bereits mit Repräsentanzbüros vertreten. Beide Büros sind mittlerweile in eigenständige legale Einheiten umgewandelt worden (China) bzw. befinden sich in der Umwandlung (Taiwan) und ermöglichen es uns zukünftig, umfangreichere Aktivitäten vor Ort auszuüben.

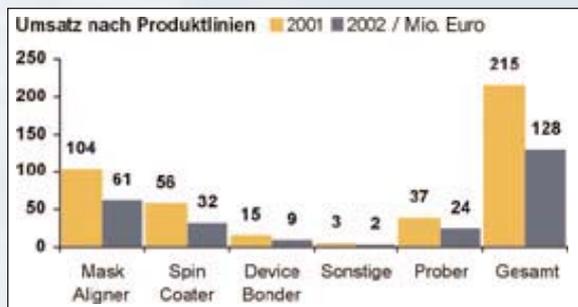
KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31.12.2002

- In Taiwan, Standort der größten Foundries der Welt, werden wir in 2003 den Kunden eine komplette Linie präsentieren und vorführen können.
- Japan betreuen wir bereits seit 15 Jahren über unsere Tochtergesellschaft vor Ort.

Bei den Chipherstellern sehen wir weitere Möglichkeiten, unsere strategische Position insbesondere bei den wichtigen potenziellen 300mm-Kunden in Nordamerika noch zu verbessern. Hier wurden bereits organisatorische Maßnahmen (Änderungen im Vertriebsmanagement und in der Kundenbetreuung durch den Vertrieb) ergriffen, um 2003 diese Kunden gezielter anzusprechen und so die spezifischen Vorteile unserer Technologie noch besser zu vermitteln.

Umsätze und Auftragslage bei den Produktlinien und Regionen

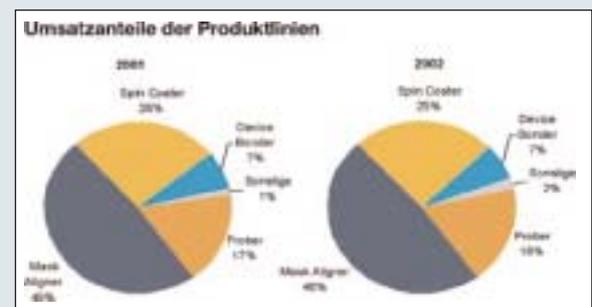
Bei der Umsatzverteilung nach Produktlinien entfallen ähnlich wie in den vergangenen Jahren 73% des Gesamtumsatzes auf die **Mask Aligner** und die **Spin Coater**.



Dabei trugen neben den 300mm-Produktionsmaschinen auch die manuellen Geräte wesentlich zum jeweiligen Umsatz bei. Die manuellen Mask Aligner und Spin Coater, die aufgrund des überwiegenden Einsatzgebietes im Entwicklungslabor naturgemäß weniger stark den Produktionszyklen der Halbleiterindustrie unterliegen, sind schon seit langer Zeit fester Bestandteil des SÜSS MicroTec-Produktportfolios. Dies beweist einerseits die hohe Qualität, Bekanntheit und Akzeptanz dieser Produkte im Laborbereich, andererseits aber auch einen relativ stabilen Markt und damit verbundenen Umsatz, den die SÜSS MicroTec-Gruppe relativ stetig für sich beanspruchen kann.

Die Umsatzentwicklung der **Device Bonder** ist im Wesentlichen von der Telekommunikationsindustrie, speziell der optischen Datenübertragung, abhängig. Dieser Markt befindet sich unverändert in einer sehr tiefgreifenden Rezession und wird sich voraussichtlich erst in den nächsten Jahren wieder zu einem wachstumsstarken Teilmarkt für SÜSS MicroTec entwickeln. Die Hauptkunden in diesem Segment sind in Nordamerika angesiedelt, wo SÜSS MicroTec in 2001 noch gute Umsätze mit diesem Produkt erzielen konnte, während in 2002 diese Region keinen nennenswerten Beitrag mehr zum Gesamtumsatz erreichte.

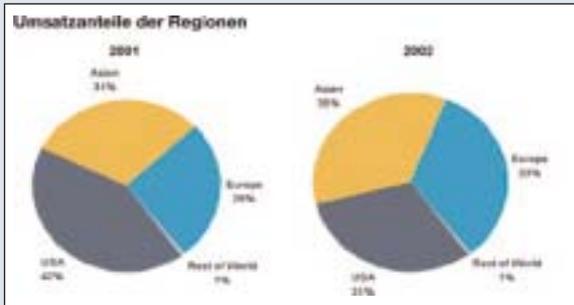
Die **Prober** sind generell relativ zu den anderen Produktgruppen bei der Auftragseingangs- und Umsatzentwicklung sehr stabil, da wir hier im Wesentlichen nur im Laborkundenbereich tätig sind. 2002 war jedoch auch in diesem Marktsegment ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, weil die allgemeine Konjunkturschwäche nun auch verstärkt den Forschungs- und Entwicklungsbereich mit Budgetkürzungen konfrontiert. In vergangenen Halbleiter-Konjunkturzyklen wurden bei den Probern geringere Schwankungen beobachtet mit der Konsequenz, dass diese Produktlinie in Abschwungphasen aufgrund der Stabilität des Geschäftes prozentual mehr Beitrag zum Gesamtumsatz lieferte.



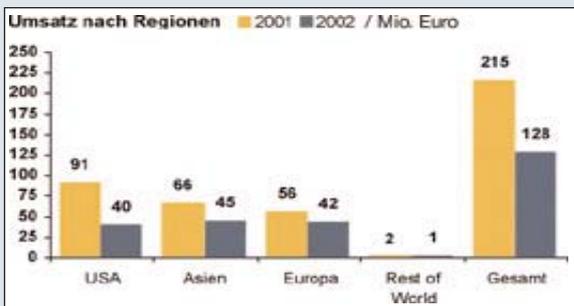
In den Regionen verzeichneten wir in 2002 folgende wesentliche Entwicklungen:

- Die Auftragsbelegung in Nordamerika im 2. Quartal war nur kurzfristig.
- Asien (ohne Japan) war vor allem aufgrund der verkauften neuen 300mm-Produktionsmaschinen stark.
- Die Entwicklung in Europa war entsprechend des geringen Anteils an Produktionsanwendungen weniger vom zyklischen Rückgang betroffen als Nordamerika.

- Japan konnte sich im gesamten Jahr 2002 nicht erholen.



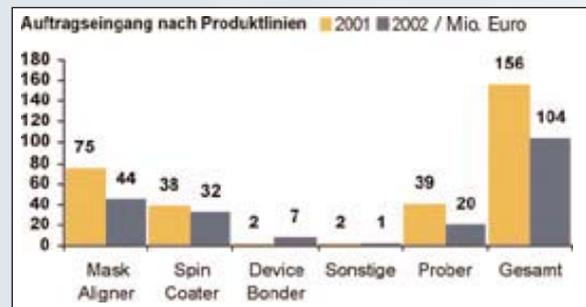
In 2002 war die Region Asien erstmals der stärkste regionale Markt für die SÜSS MicroTec-Gruppe. Nordamerika fiel noch hinter Europa auf den dritten Rang zurück. Wir sehen, dass sich mit dem Advanced Packaging für SÜSS MicroTec der Markt mehr nach Asien hin verschiebt. Die Schwäche Nordamerikas wird jedoch nicht als Teil einer grundsätzlichen regionalen Verschiebung gesehen, sondern hängt im Wesentlichen mit dem ausbleibenden Geschäft für Produktionsmaschinen zusammen. Sobald sich die zyklische Konjunktur der Halbleiterindustrie wieder erholt, werden auch wieder entsprechend mehr Umsätze in Nordamerika erzielt. Wir erwarten aber dennoch, dass Asien und Nordamerika sich zukünftig als relativ gleich starke Regionen für uns entwickeln werden, während wir für Europa im Trend eher sinkende Umsatzanteile erwarten.



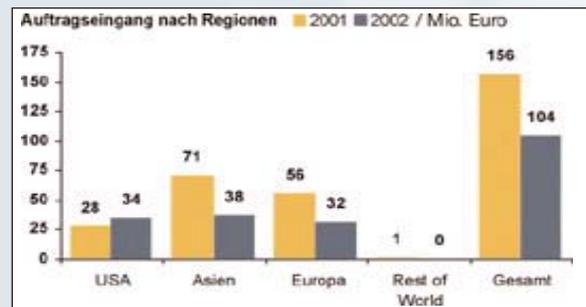
Die erfreuliche Entwicklung in Asien (ohne Japan) war in 2002 in der Betrachtung der Regionen das einzig positive Moment. Alle anderen Regionen entwickelten sich analog zum gesamten Konzern negativ. Hinzu kam für Nordamerika der insbesondere im 4. Quartal deutlich gestiegene

Euro, der sowohl die Margen als auch den in EURO konvertierten konsolidierten Umsatz entsprechend belastete.

Auftragslage



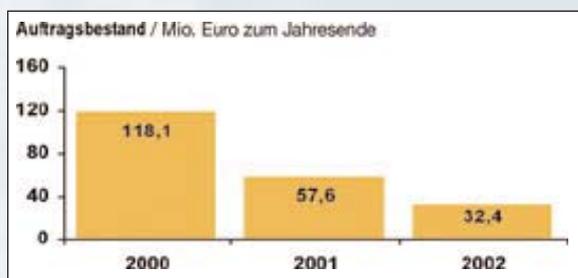
Bei den Auftragseingängen spiegelt sich im Wesentlichen die Umsatzentwicklung nach Produkten und Regionen wider. In 2002 hing der Geschäftsverlauf in den einzelnen Regionen vor allem von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in der entsprechenden Region ab. Somit wurden alle Produktlinien gleichermaßen von dem negativen Konjunkturtrend erfasst. In 2001 war vor allem das Segment der Telekommunikation von Rezession betroffen und traf vorwiegend die Produktlinie der Device Bonder.



Das Verhältnis zwischen neu eingegangenen Aufträgen und den realisierten Umsätzen, die sogenannte book-to-bill ratio, lag bei 0,82 (2001: 0,73). Es kam zu einem weiter verringerten Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2002.

Der Auftragsbestand enthält üblicherweise Aufträge für die nächsten 3 bis 6 Monate, wobei in Ausnahmefällen auch spätere Liefertermine fixiert sein können.

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31.12.2002



Die absoluten Zahlen für Aufträge und Umsatz lesen sich im Vergleich zu 2001 zwar als erheblicher Rückgang, zeigen aber dennoch, dass wir im Vergleich zu unseren wichtigsten Konkurrenten Marktanteile halten oder sogar ausbauen konnten. Diese Einschätzung beruht auf veröffentlichten Umsatzzahlen, auf der Auswertung einzelner Wettbewerbssituationen oder, wo keine anderen Zahlen vorlagen, auf eigenen Schätzungen. Dieses Ergebnis ist vor allem deshalb als sehr positiv anzusehen, weil es die Akzeptanz des Produktportfolios durch den Markt sowie die gute Aufstellung der Vertriebsorganisation in den Regionen zeigt. Darüber hinaus erfolgt erfahrungsgemäß in der Abschwungphase eines Halbleiterzyklus die Positionierung für den nächsten Aufschwung. In der gegenwärtigen Phase ist SÜSS MicroTec auf den nächsten Aufschwung sehr gut vorbereitet.

Finanzielle Entwicklung

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die im Januar 2002 durchgeführte Kapitalerhöhung hatte signifikante positive Auswirkungen auf die Bilanzstruktur und die Liquidität der Gruppe. So wurde ein großer Teil der zugeflossenen Mittel von 34,5 Mio. EURO zur Tilgung laufender Bankverbindlichkeiten verwendet. In der Folge stieg das Volumen der von der Muttergesellschaft an die Töchter gegebenen Finanzmittel (Ausleihungen und kurzfristige Finanzierungen) von 48,9 Mio. EURO (31.12.2001) auf 55,7 Mio. EURO (31.12.2002). Dies hat in der Zukunft höhere Zinserträge bei der SÜSS MicroTec AG zur Folge (siehe hierzu auch „Die Holding“). Die Finanzschulden (liquide Mittel abzüglich aller Finanzverbindlichkeiten ohne Pensionsverbindlichkeiten) der Gruppe reduzierten sich in der Folge um 32,4 Mio. EURO auf 4,7 Mio. EURO.

Auch aufgrund der nicht mehr anfallenden Goodwill-Abschreibungen (Vorjahr: 4,3 Mio. EURO) entsteht zusätzlich

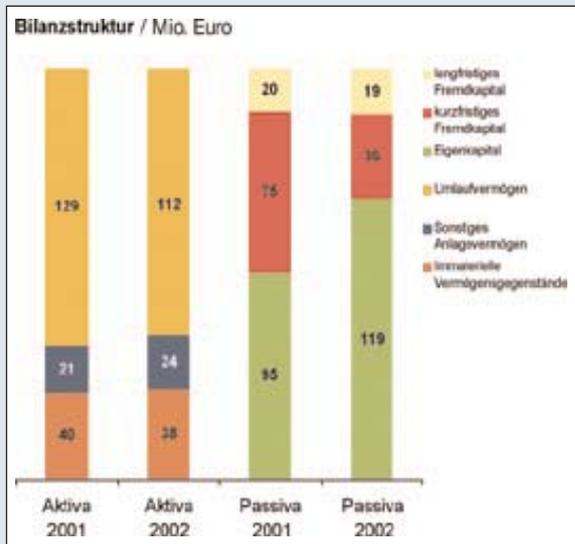
eine positive Wirkung auf die Konzern-Eigenkapitalquote (2002: 68% gegenüber 50% 2001), so dass die Bilanzstruktur sich trotz des Jahresfehlbetrages deutlich positiv entwickelte.

Auf der Aktivseite stellt der Lagerbestand immer noch eine wesentliche Größe dar. Unser Ziel ist es, den Lagerbestand auf eine Reichweite von nicht mehr als 180 bis 200 Tagen zu reduzieren. Für 2002 würde dies rechnerisch einen Ziel-Lagerbestand von etwa 35 Mio. EURO bedeuten, womit der derzeitige Bestand noch deutlich über diesem Zielwert liegt. Die ersten Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles wurden im Rahmen der Restrukturierung eingeleitet und zeigten bereits Erfolge im 4. Quartal des abgelaufenen Jahres. So verringerte sich der Bestand im 4. Quartal 2002 um rund 13 Mio. EURO. Wir sehen es als ein wesentliches Ziel in 2003 an, bei den Investitionen in das Working Capital eine deutliche Reduzierung vor allem durch den Lagerabbau zu erreichen.

Die Zahlungsmoral der Kunden blieb bei der Analyse der Außenstandstage zum Ende des Jahres 2002 mit 72 (2001: 72) Außenstandstagen (Days Sales Outstanding; DSO) konstant positiv. Dies ist im Wesentlichen auf Großaufträge aus Asien im 4. Quartal zurückzuführen, bei denen mittels Akkreditiven sehr kurzfristig nach der Lieferung wesentliche Zahlungseingänge erfolgten. Wir erwarten aber bei einer ausgeglichenen Geschäftsverteilung innerhalb der verschiedenen Regionen wieder einen DSO-Wert von 75-85, weil die positive Wirkung solcher Akkreditive in Asien anteilig am Gesamtforderungsbestand dann wieder abnimmt.

Auf der Passivseite sind weiterhin die im Vergleich zu vergangenen Jahren geringen Kundenanzahlungen zu verzeichnen (Ende 2002 3,4 Mio. EURO gegenüber 6,9 Mio. EURO Ende 2001). Dies ist nicht nur auf die niedrigeren Auftragseingänge zurückzuführen, sondern auch auf die derzeit herrschenden schwierigen Rahmenbedingungen bei den Verhandlungen.

Wir sind überzeugt, dass sich bei Aufschwungphasen wieder deutlich verbesserte Anzahlungsquoten erzielen lassen, die dann zu einer Verbesserung des Working Capital und des operativen Cash Flow führen können. Eine signifikant positive Entwicklung bei dieser Position sehen wir allerdings noch nicht für 2003.



Grundsätzlich stellt sich die Bilanzstruktur des Konzerns am Ende des Jahres 2002 aus unserer Sicht vor allem aufgrund der Eigenkapitalquote und der geringen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten als sehr gesund und solide dar. Wir sind davon überzeugt, dass auch im Falle einer weiterhin schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in 2003 das Unternehmen aufgrund der Bilanzstruktur auf ein solches Szenario vorbereitet ist.

Per Ende des Jahres 2002 verfügte der Konzern über 16,9 Mio. EURO liquide Mittel, denen 3,5 Mio. EURO kurzfristige Bankverbindlichkeiten gegenüber standen. Die verfügbare offene Kreditlinie zum Jahresende lag bei 14,7 Mio. EURO, so dass die verfügbare Liquidität insgesamt mehr als 28 Mio. EURO betrug. Ein Anstieg der Kreditlinien ist derzeit Ziel von Verhandlungen mit den Banken.

INVESTITIONEN

Wesentliche Investitionen in 2002 erfolgten in folgenden Projekten:

- 3,4 Mio. EURO für den Erwerb des Betriebes der BLE GmbH, Singen;
- 0,6 Mio. EURO für den Kauf von weiteren ORACLE-Lizenzen;
- 0,5 Mio. EURO im Rahmen des Ausbaus des Standortes Frankreich;
- 0,3 Mio. EURO Restinvestitionen für Laser-Writer bei Image Technologies.

Weitere Investitionen erfolgten auf verringertem Niveau im Rahmen von Ersatzinvestitionen für Büroeinrichtungen und Equipment für die Fertigungsbereiche.

ERTRAGSLAGE

Die Margen stellen eine wesentliche Komponente für die Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens dar. Bei der Margenentwicklung zeigte sich in 2002 ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2001, der vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

- Überkapazitäten im Produktionsbereich führten zu geringerer Auslastung mit Leerzeiten und höheren Ist-kosten-Verrechnungssätzen.
- Die Marktsituation führte zu deutlich erhöhtem Preisdruck und der Notwendigkeit, insbesondere in den USA höhere Discounts zu gewähren (5,8% in 2002 gegenüber 2,1% in 2001).
- Der hohe Lagerbestand führte zu entsprechend erhöhten Wertberichtigungen bei den Rohmaterialien und Fertigerzeugnissen.
- Der stärker werdende EURO führte zu verringerten Margen insbesondere in Nordamerika.

Aufgrund der Auftragssituation sah sich die Gruppe gezwungen, durch entsprechende Änderungen in den Arbeitszeitmodellen und durch Betriebsferien einen weiteren Zuwachs des Lagers zu vermeiden. Diese Maßnahmen führten zu entsprechenden Margenbelastungen, da beispielsweise Minderarbeit („Arbeitszeitschulden“) der Mitarbeiter nicht aktiviert, sondern ergebniswirksam in den Herstellungskosten verbucht wurde. Um eine latente Überbewertung des Lagerbestandes zu vermeiden, bewirkten die installierten Standardregeln einen erhöhten Aufwand bei der Wertberichtigung auf die Lagerbestände. Diese Wertberichtigungen können beim Verkauf des entsprechenden Gutes zu dann erhöhten Margen führen.



KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31.12.2002

Eine wieder verbesserte Margensituation bereits in 2003 erwarten wir vor allem

- aufgrund der nicht mehr in gleichem Maße vorhandenen Überkapazitäten und damit verringerten Leerkosten sowie wegfallender Restrukturierungskosten;
- durch einen weiteren Abbau des Lagerbestandes mit entsprechend reduziertem Wertberichtigungsbedarf;
- durch einen Anstieg der Lernkurve bei den neuen 300mm-Produkten mit entsprechend reduzierten Herstellungskosten.

Die weitere Entwicklung der Wechselkursverhältnisse werden wir sorgfältig verfolgen, um bei entsprechendem Bedarf die Aufteilung der Wertschöpfung zwischen den Währungsräumen zu optimieren. Nur bedingt kontrollierbare Risiken für die Marge in 2003 bestehen bei einem weiteren Anstieg des EURO gegenüber dem US-Dollar.

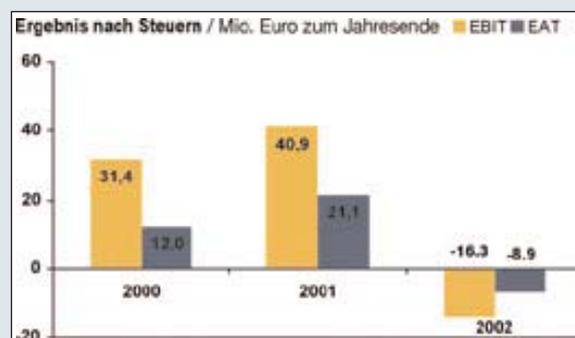
Die Kosten im Verwaltungs- und Vertriebsbereich sind vor allem durch die vorhandene Anzahl der Mitarbeiter bestimmt. In Relation zum Gesamtumsatz ging der Nettoumsatz pro Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurück (2002: 0,145 Mio. EURO gegenüber 0,225 Mio. EURO in 2001) und führte in der Konsequenz durch den geringeren Umsatz und die geringere Marge zu nicht mehr ausreichender Deckung dieser Kosten.

Aufgrund der neuen Rechnungslegungsvorschriften in US-GAAP (SFAS 142 bestimmt, dass Goodwill nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern aufgrund jährlicher Werthaltigkeitstests überprüft wird. Nur bei einem identifizierten Wertberichtigungsbedarf fallen hier Aufwendungen an) fielen in 2002 keine planmäßigen Goodwill-Abschreibungen mehr an, so dass bei einem Vergleich mit 2001 insbesondere das EBITDA eine erhöhte Aussagekraft besitzt.

Im Finanz- und sonstigen Ergebnis konnten vor allem aufgrund der Kapitalerhöhung die Zinsaufwendungen reduziert werden. Andererseits führte der starke EURO zu Buchverlusten bei internen USD-Darlehen. Diese Buchverluste würden bei einer Abschwächung des EURO wieder anteilig zu Buchgewinnen führen.

Im Steuerergebnis ist als eine wesentliche Komponente die anteilige Aktivierung eines ehemals voll wertberichtig-

ten Verlustvortrages bei der Tochtergesellschaft MFI Inc., Kanada enthalten, der durch einen entstandenen Gewinn durch Übertragung des gesamten Know how inklusive der Patente an Dresden genutzt wurde. Dieser steuerliche Sondereffekt wird in 2003 nicht mehr auftreten.



Im 4. Quartal 2002 wurde ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm eingeleitet, um die Unternehmensstrukturen den entsprechenden geänderten Bedingungen anzupassen (siehe auch „Mitarbeiter“). Diese führten zu Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. EURO in 2002, von denen 2002 bereits 0,3 Mio. EURO bezahlt wurden.

Dieses Programm wird im Wesentlichen zu verbesserten Margen und zu deutlich geringeren Verwaltungs- und Vertriebskosten führen. Flankiert wird dieses Programm durch weitere Kostensenkungsprogramme in den Bereichen Werbung, Beratung, Reisekosten und Investitionen. Den strategisch wichtigen Bereich der Forschung und Entwicklung haben wir nicht in gleichem Maße restrukturiert, da unserer Überzeugung nach Einsparungen in diesem Bereich die zukünftige Geschäftsentwicklung negativ belasten würden.

DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt u.a. die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für die Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verantwortlich.

Die Holding ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an

den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen, hier vor allem die SMTL GmbH, Garching, die SMTLE GmbH, Singen, im Inland und die SÜSS MicroTec, Inc. USA sowie die SÜSS MicroTec KK, Japan.

Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften. Hinzu kommen entsprechende Zinserträge durch die Vergabe von konzerninternen Krediten.

Ohne Sondereffekte erzielt die Holding in der Regel einen Jahresüberschuss vor allem aufgrund des Finanzergebnisses, bei den durch interne Darlehensvergaben und kurzfristige Finanzierungen entsprechende Zinseinkünfte entstehen.

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Holding für das Geschäftsjahr 2002 waren vor allem folgende Sondereffekte für den Jahresfehlbetrag von -1,656 Mio. EURO verantwortlich:

- Die Buchverluste auf gegebene und nicht gesicherte US-Dollar Darlehen.
- Die als Aufwand verbuchten Kosten der Kapitalerhöhung.
- Abwertungen auf die Beteiligung am Teilkonzern MFI.

Die Bilanz der Holding hat sich insoweit geändert, dass die Tochtergesellschaften deutlich erhöhte konzerninterne Darlehen und kurzfristige Finanzierungen von der Holding erhalten haben. Hintergrund war vor allem die Rückführung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten im Konzern von 29,5 Mio. EURO Ende 2001 auf 3,5 Mio. EURO Ende 2002 und damit die Vermeidung von Zinszahlungen des Konzerns an Dritte im kurzfristigen Bereich. Die langfristigen Darlehen blieben dabei unberührt und wurden nicht vorab abgelöst.

Aufgrund der Durchleitung der erhaltenen Mittel aus der Kapitalerhöhung an die Tochtergesellschaften erwarten wir zukünftig eine gesicherte Ertragslage bei der Holding, da wir bei den genannten Sondereffekten zukünftig keine entsprechenden Ergebnisbelastungen in dieser Höhe erwarten.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der SÜSS MicroTec AG (Handelsrecht)

	2002	2001	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag/				
-überschuss	-1.656	3.674	-5.329	-145
Eigenkapital	99.769	65.213	34.556	53
Bilanzsumme	117.555	105.861	11.694	11
EK-Quote in %	85	62		
Anlagevermögen	74.844	74.035	809	1
% der Bilanzsumme	64	70		
Umlaufvermögen	42.482	31.647	10.835	34
% der Bilanzsumme	36	30		

Darstellung der finanziellen Kennzahlen des Konzerns (US-GAAP)

	2002	2001	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag/				
-überschuss	-8.938	21.079	-30.017	-142
Eigenkapital	118.534	95.356	23.177	24
Bilanzsumme	173.956	190.505	-16.549	-9
EK-Quote in %	68	50		
Anlagevermögen	61.263	61.192	71	0
% der Bilanzsumme	35	32		
Umlaufvermögen	112.693	129.312	-16.619	-13
% der Bilanzsumme	65	68		

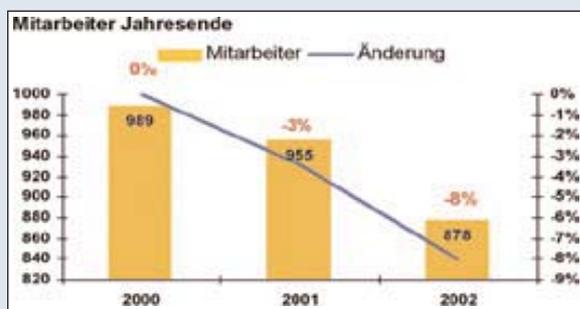
Mitarbeiter

In der SÜSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschäftsjahres 2002 18 Mitarbeiter und 2 Vorstände tätig.

Zu Beginn des Jahres 2002 waren 955 Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt. Mit dem Kauf der Vermögensgegenstände aus der insolventen B.L.E. GmbH, Singen, wurden auch mit 38 Mitarbeitern neue Anstellungsverträge abgeschlossen. So erreichte die Mitarbeiterzahl im Monat Februar mit 1.007 in 2002 seinen Höchststand.

Im Sommer 2002 wurde in einer ersten Phase der Abbau von etwa 80 Mitarbeitern beschlossen und durchgeführt. Dies erfolgte im Wesentlichen durch nicht mehr erfolgte Nachbesetzung, z.B. bei Ruhestand, und durch Kündigungen von Mitarbeitern während der Probezeit. Dadurch entstanden auch keine wesentlichen Kosten.

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31.12.2002

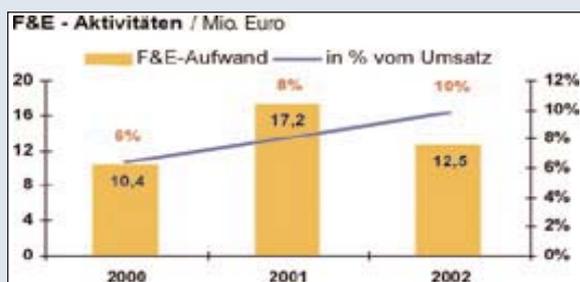


Im Herbst 2002 musste eine zweite Phase eingeleitet werden, die insgesamt 174 Mitarbeiter betraf. Hier fielen entsprechende Restrukturierungskosten in Höhe von 2,4 Mio. EURO an, die in den Anhangsangaben entsprechend dargestellt werden. Am Ende des ersten Quartals 2003 werden alle betroffenen Mitarbeiter das jeweilige Unternehmen verlassen haben, soweit dies noch nicht in 2002 geschehen ist.

Somit wird die Anzahl der Mitarbeiter (878 zum Jahresende 2002) im ersten Quartal 2003 noch weiter auf 766 zurückgehen. Dieser Abbau wurde begleitet von entsprechenden organisatorischen Änderungen in den wesentlichen operativen Gesellschaften des Konzerns. Dadurch wurde sicher gestellt, dass die operativen Prozesse in den Gesellschaften weiterhin stabil bleiben und unsere Produkte und Dienstleistungen für Kunden keine Qualitätsverluste durch die Restrukturierung erleiden.

Forschung und Entwicklung

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind von wesentlicher Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit sowohl der bestehenden als auch für die Entwicklung neuer Produkte. Daher ist dieser Bereich von Restrukturierungsmaßnahmen weit weniger betroffen als andere.



Wesentliche Projekte in 2002 dienten der Verbesserung bestehender Produkte oder stellen Entwicklungsprojekte im Rahmen unserer Roadmap dar:

- Laufendes Continuous Improvement Program für die neuen 300mm-Mask Aligner und Spin Coater (Einzelmaschinen und Clustersystem) im Rahmen der Produkteinführung.
- Entwicklungsprogramme bei den Bonder-Systemen für 300mm und SOI-Bonding (Silicon on Insulator).
- Forschungsprojekte im Bereich der Lithographie, mit deren Ergebnis es unseren Mask Alignern ermöglicht werden soll, in feinere Strukturbereiche vorzustoßen.

Auch zukünftig werden wir bei der Kürzung von Mitteln darauf achten, dass notwendige und aussichtsreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte nicht beeinträchtigt werden.

Ausblick

Die gegenwärtigen Erwartungen vieler Analysten sehen eine tendenziell positive Umsatzentwicklung für die Halbleiter-Equipment-Industrie im laufenden Jahr voraus. Diese Erwartung stützt sich im Wesentlichen auf die Prognose eines sich erholenden Konsums von elektronischen Produkten.

Die momentane Entwicklung, sowohl unserer angestammten Märkte als auch der weltwirtschaftlichen und weltpolitische Lage, geben derzeit jedoch noch keinen Anlass, für 2003 eine deutliche Belebung zu erwarten. Zumindest für die ersten beiden Quartale gehen wir derzeit von einem Umsatzniveau noch unterhalb der Werte von 2002 aus. Die Stärke des erwarteten Rückgangs hängt nicht unwesentlich auch von der Entwicklung der Wechselkurse ab.

Beim Ergebnis erwarten wir (wie in den vergangenen Jahren) im ersten Halbjahr einen Verlust, wobei wir oberste Priorität auf die positive Entwicklung des Free Cash Flows legen. Wir erwarten über das laufende Jahr hinweg auch dann keine signifikanten Geldabflüsse, selbst wenn sich der Umsatz nochmals reduzieren würde.

Für das zweite Halbjahr kann derzeit keine Umsatz- und Ergebnisprognose abgegeben werden. Sowohl ein flacher Verlauf auf dem Niveau des ersten Halbjahres ist möglich als auch eine Belebung, die für das zweite Halbjahr eine Verdoppelung des Geschäftes bedeuten könnte. Jedoch: Bereits in 2002 haben viele der üblichen Indikatoren ihre Aussagekraft

verloren; ein Ausblick kann nur in Form einer Bandbreite gegeben werden.

Bei der Ertragssituation war Ziel der 2002 umgesetzten Maßnahmen, bei einem Umsatz von etwa 120 Mio. EURO ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Diese Größenordnung sehen wir für 2003 als erreichbar an, weisen aber darauf hin, dass bei Eintreffen verschiedener Szenarien der Gesamtumsatz 2003 sich in einer Bandbreite von unter 100 bis deutlich über 150 Mio. EURO bewegen kann. Aus derzeitiger Sicht schließen wir uns den Meinungen verschiedener marktführender Unternehmen der Branche an und sind für das zweite Halbjahr zumindest bei der Auftragslage verhalten optimistisch.

Bei den einzelnen Anwendungsfeldern sind dabei folgende Entwicklungen für eine Belebung der Auftragsituation entscheidend:

ADVANCED PACKAGING

- Viele Chiphersteller oder sogenannte Packaging Foundries haben in den vergangenen Jahren die Technologie des Advanced Packaging eingeführt. Dabei wurden aufgrund des schwierigen Marktumfeldes nur die minimal möglichen Produktionskapazitäten installiert. Schon bei einem leichten Anstieg der Nachfrage nach entsprechenden elektronischen Produkten werden neue Investitionen erforderlich.
- Weitergehende Entwicklungen hin zu kleineren leistungsfähigeren Geräten erfordern neue Chip-Verbindungstechniken. Nach den Mikroprozessoren werden inzwischen auch weniger komplexe Chips, wie DSP oder Logic-Bausteine, mit den Methoden des Advanced Packaging verarbeitet.
- Ein zukünftig sehr wichtiges Anwendungssegment des Advanced Packaging wird im Bereich der Speicher-Chips (DRAM) liegen. Während die DRAM-Fertigung sich heute noch ausschließlich klassischer Packaging-Techniken bedient, wird auch dieser Markt zukünftig mehr und mehr die Vorteile des Advanced Packagings nutzen. Vor allem bei der Fertigung von DRAM-Chips auf den neuen 300mm Wafer-Formaten erwarten wir erst in den nächsten Jahren nennenswerte Umsatzbeiträge; für das Geschäftsjahr 2003 werden hier noch keine Umsatzimpulse zu verbuchen sein.

VERBINDUNGSHALBLEITER (COMPOUND SEMICONDUCTOR)

- Dieser Bereich ist im Wesentlichen durch Anwendungen

der Telekommunikation beeinflusst. In den Jahren 1999 und 2000 ist es zu erheblichen Überinvestitionen, insbesondere bei den optischen Datennetzwerken, gekommen. Die hiermit verbundenen Überkapazitäten in den Produktionsstätten der Hersteller optischer Übertragungselemente werden erst langsam ausgelastet, so dass es hier erst bei stärkerem Anstieg der Nachfrage wieder zu neuen Investitionen kommen wird.

- Eine deutliche Erholung der Telekommunikationsindustrie wird noch nicht für 2003 erwartet. Neue Technologien wie UMTS und die Ausweitung der Möglichkeiten der Mobiltelefone sollen das Konsumklima verbessern, werden sich aber erst in den nächsten Jahren wirtschaftlich bemerkbar machen.
- Die gegenwärtige Wettbewerbssituation bei den Netzwerkausrüstern könnte sich durch entsprechende Konsolidierungen oder den Ausstieg einzelner Wettbewerber aus einzelnen Segmenten erheblich verändern. Dies würde zu einer verbesserten Ertragssituation und höheren Produktionsauslastung bei den verbliebenen Marktteilnehmern und damit auch wieder zu einem verbesserten Investitionsklima führen.

MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS, MOEMS)

- Die Mikrosystemtechnik unterscheidet sich von den anderen Feldern durch eine deutlich höhere Diversifizierung, sowohl bei den Produkten selbst, als auch bei den Herstellern dieser Produkte. Im Gegensatz zum Mikrochip, der in der Regel in großen Stückzahlen extrem kostengünstig gefertigt wird, sind bei den Mikrosystemen die Stückzahlen deutlich geringer und die Variantenvielfalt deutlich höher. Damit hängt die Mikrosystemtechnik nicht an einzelnen Endmärkten, sondern wird vielmehr durch die allgemeine Konjunktur und das Investitionsklima beeinflusst.
- Die derzeit stärksten Impulse für die Mikrosystemtechnik kommen nach wie vor von der Automobilindustrie. Aber auch andere Endmärkte, wie die Umweltsensorik, die Biotechnologien, die chemische Industrie und die neuen Nanotechnologien, bieten neue Produktchancen für die Mikrosystemtechnik. Mit einer Verbesserung des allgemeinen Investitionsklimas werden auch hier neue Impulse erwartet.
- Die Entwicklungsanstrengungen, die auch in den beiden letzten, sehr schwierigen Jahren weitergeführt wurden, haben zu einer Reihe neuer Produkte oder zu neuen Produktverbesserungen geführt. Insbesondere bei den Waferbondern, einem Produkt speziell für die Mikrosystemtechnik, wurde mit der

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31.12.2002

Zusammenfassung der Verantwortlichkeit an einem Standort in den USA die eigene Wettbewerbsposition deutlich gestärkt. Hier erwarten wir eine steigende Umsatzentwicklung schon im Jahre 2003 und darüber hinaus einen weiteren Ausbau unseres Marktanteils auf deutlich über 50%.

TESTSYSTEME

- Die Produktlinie der Testsysteme hängt für SÜSS MicroTec historisch weit weniger von den Halbleiterzyklen ab, da hier keine Produktionsgeräte, sondern nur Geräte für Anwendungen im analytischen Bereich der Entwicklung oder der Fehlerverfolgung angeboten werden. Diese Anwendungen werden sehr stark von dem allgemeinen Investitionsklima der Halbleiterindustrie oder anderer Märkte der Hochtechnologie beeinflusst. Mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmendaten weltweit werden hier wieder stärkere Zuwächse auch für SÜSS MicroTec erwartet.
- Die Entwicklung neuer Produkte, die erst in 2002 wesentlich in den Markt eingeführt wurden, lässt eine weitere Steigerung des Umsatzes in 2003 zu.
 - Auf der Basis der Technologie des im Jahre 2001 übernommenen Unternehmens MFI wurden neue Testspitzen für das Testen extrem kleiner Strukturen auf einem Mikrochip weiterentwickelt. Erste Aufträge konnten verbucht werden; die breitere Markteinführung ist für 2003 geplant.
 - Neue, sogenannte Cryo-Prober, Geräte, die das Testen von Schaltkreisen bei extrem niedrigen Temperaturen von unter -270 °C erlauben, werden vor allem in der Mikrosystemtechnik eingesetzt.
 - Mit neu entwickelten MEMS-Probern für das Testen von Sensoren wurde ein äußerst interessantes Anwendungsfeld für die Testgeräte von SÜSS MicroTec eröffnet. Das Testen von Mikrosystemen war bisher ein ungelöstes Problem bei der Herstellung von Sensoren.

Innerhalb der Regionen sehen wir für 2003 wieder einen größeren Anteil von Nordamerika am Gesamtumsatz. Langfristig gehen wir von etwa gleich starken Regionen Nordamerika und Asien aus, während Europa und der Rest der Welt etwa 20-25% zum Gesamtumsatz beitragen werden.

Wir sehen das langfristige Potenzial unserer Produkte, insbesondere beim Advanced Packaging, unverändert positiv. Das Jahr 2002 folgte auf sehr erfolgreiche Jahre 2000 und 2001 und sollte nicht für sich alleine betrachtet werden. Die gesamte Industrie befindet sich in einer rezessiven Phase, die auch

unsere Geschäftsfelder nicht unberührt gelassen hat. Innerhalb dieser Geschäftsfelder hat sich jedoch die Marktposition unserer Firma relativ zu den direkten Wettbewerbern weiterhin verbessert. SÜSS MicroTec ist damit für den kommenden Aufschwung bestens gerüstet.

Risiken für die weitere Geschäftsentwicklung

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

ALLGEMEINE RISIKEN

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die anhaltende Krise des Halbleitermarktes und die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört weiterhin zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesem Risiko begegnen wir durch die angepassten Strukturen, die bei wieder zunehmender Geschäftstätigkeit nicht mehr in der gleichen Form wie 2000 und 2001 intern, sondern vor allem extern durch Outsourcing ausgeweitet werden sollen.

Zugang zu Fremdkapital

Wir erwarten zukünftig geänderte Rahmenbedingungen in der Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Einführung von Basel II. Die Minimierung der Abhängigkeit insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir entgegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten.

Währungseinflüsse

Ein grundsätzliches Risiko könnte ein weiteres langfristiges Erstarken des EURO gegenüber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen bedeuten, da ab einer gewissen Grenze die derzeitige Aufteilung der Wertschöpfung nicht mehr ergebnisoptimal wäre. Kurzfristige Schwankungen gleichen wir in der Regel durch Sicherungsgeschäfte aus.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten

Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und dem laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Leitkunden.

Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität, kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko minimiert.

Abhängigkeit von einzelnen Know how-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung, abhängig. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert werden soll.

AKTUELLE RISIKEN

Struktur und Organisation

Die notwendigen Anpassungen der Mitarbeiterzahlen und die damit einher gehenden organisatorischen Veränderungen bergen ein Risiko geringerer Prozessqualität in den Abläufen. Dies könnte sich auch auf die Geschäftsentwicklung auswirken.

Vermögens- und Ertragslage

Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Konzernbilanz könnten bei anhaltend geringen Umsätzen entsprechende Wertberichtigungen notwendig werden. Diese hätten zwar keine wesentlichen Wirkungen auf die Liquidität, aber auf die Ergebnissituation der Gruppe bzw. der Holding. Durch konzernweit gültige Bewertungsregelungen werden bei den Lagerwerten durch entsprechende Wertberichtigungen latente Überbewertungen vermieden.

Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht ein deutlich erhöhter Preisdruck. Dieser birgt das Risiko, dass auch bei erholenden Märkten

ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik, im Zuge der wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge verzichten, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Finanzlage

Bei der Liquiditätssituation sehen wir die Risiken im kurzfristigen Bereich als beherrschbar an, da die Restrukturierungsmaßnahmen zu erheblichen Einsparungen auf der Ausgaben-seite führen. Erst bei einer langfristigen andauernden schwachen Entwicklung sehen wir weitere umfassende Maßnahmen zur Anpassung der Ausgaben als notwendig an.

Politische Rahmenbedingungen

Im Wesentlichen die Krisensituationen im Irak und in Nordkorea könnten kurzfristig erhebliche Wirkungen auf die Weltwirtschaft haben, sei es durch Ausbruch eines Krieges oder Wirkungen auf den Ölpreis. Eine Eskalation würde erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf 2003 nehmen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 20.01.2003 wurde die Umwandlung des Vertriebsbüros in Shanghai zu einer legalen Einheit genehmigt.

Am 12.02.2003 wurde auf Basis eines Vorstandsbeschlusses vom 27.01.2003 die Verlagerung des Standortes Singen der SÜSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH nach Vaihingen verkündet. Hierfür lag dem Vorstand bereits eine Ermächtigung durch den Aufsichtsrat vor.

Diese Verlagerung beinhaltete auch Änderungskündigungen an alle 40 Mitarbeiter des Standortes Singen mit dem Angebot, bei der neuen Betriebsstätte in Vaihingen tätig zu werden. Aufgrund heute vorliegender Informationen rechnen wir damit, dass 4 Mitarbeiter dieses Angebot wahrnehmen werden. Der übrige Teil, 36 Mitarbeiter, wird zum 31.03.2003 das Unternehmen verlassen.

Garching, 20. März 2003
Der Vorstand



Dr. Franz Richter



Stephan Schulak

I KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2001- 31.12.2001
Umsatzerlöse	132.379	222.721
Frachtkosten und Provisionen	-4.864	-7.952
Umsatzerlöse netto	127.515	214.769
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-79.598	-100.432
Bruttoergebnis vom Umsatz	47.917	114.337
Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten	-48.006	-54.679
Forschungs- und Entwicklungskosten	-12.537	-16.731
Aufwendungen für erworbene nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsleistungen	0	-468
Abschreibung Goodwill	0	-4.344
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge (Anhang Nr. V.1)	-401	2.978
Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung	-3.319	-239
Operatives Ergebnis	-16.346	40.854
Zinsaufwendungen	-1.309	-2.060
Zinserträge	479	165
Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis	6	0
Ergebnis vor Steuern	-17.170	38.959
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.232	-17.880
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-8.938	21.079
Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*	-16.340	40.854
Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*	-9.419	50.406
Pro Aktie (Anhang Nr. IV.7):		
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,60	1,53
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,60	1,53
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-8.938	21.079
Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern (Anhang Nr. IV.7)		
Fremdwährungsdifferenzen	-3.192	-247
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung	-42	-1
Comprehensive Income	-12.172	20.831

*) ungeprüft

KONZERNBILANZ

TEUR	zum 31.12.2002	zum 31.12.2001
AKTIVA		
Flüssige Mittel (Anhang Nr. III.3)	16.914	7.459
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto (Anhang Nr. III.4)	34.105	50.804
Sonstige kurzfristige Forderungen (Anhang Nr. III.5)	9.249	3.544
Vorräte, netto (Anhang Nr. III.6)	48.062	61.060
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	958	1.058
Kurzfristige aktive latente Steuern (Anhang Nr. V.2)	3.405	5.387
Summe Umlaufvermögen	112.693	129.312
Sachanlagen (Anhang Nr. III.8)	16.592	18.755
Immaterielle Vermögensgegenstände (Anhang Nr. III.9)	9.679	12.069
Goodwill (Anhang Nr. III.9)	28.009	28.009
Finanzanlagen (Anhang Nr. III.10)	148	253
Langfristige aktive latente Steuern (Anhang Nr. V.2)	4.895	357
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände (Anhang Nr. III.11)	1.940	1.750
Summe Aktiva	173.956	190.505
PASSIVA		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.1)	3.531	29.522
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.2)	275	396
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.934	7.477
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.3)	223	513
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.4)	3.546	2.634
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.5)	24.432	34.538
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	35.941	75.080
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.4)	14.501	12.402
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.2)	613	626
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.3)	3.580	3.533
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten (Anhang Nr. IV.6)	735	3.508
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	52	0
Summe langfristige Verbindlichkeiten	19.481	20.069
Gezeichnetes Kapital (Anhang Nr. VI.7) / Genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 19.500 (31.12.2001) und (in tsd.) 22.423 (31.12.2002); davon ausgegeben (in tsd.) 13.802 (31.12.2001) und (in tsd.) 14.957 (31.12.2002)	14.957	13.802
Kapitalrücklage	80.911	46.716
Gewinnrücklagen	433	433
Gewinnvortrag	25.637	34.575
Kumuliertes Other Comprehensive Income (Anhang Nr. IV.7)	-3.404	-170
Summe Eigenkapital	118.534	95.356
Summe Passiva	173.956	190.505

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2001- 31.12.2001
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-8.938	21.079
Wechselkursbedingte Veränderung des Eigenkapitals	-1.505	-299
Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrag/-überschuss zum Mittelabfluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit		
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	1.430	1.535
Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhöhung	514	0
Aufwendungen für erworbene nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsleistungen	0	468
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	1.796
Abschreibung auf den Goodwill	0	4.344
Abschreibung auf Finanzanlagen	0	15
Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis	106	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	4.174	2.996
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	547	416
Zunahme / Abnahme der aktiven latenten Steuern	-2.556	1.013
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	-20	133
Gewinn aus Beteiligungen	-1	-6
Zunahme / Abnahme der Wertberichtigung auf Forderungen	-167	62
Zunahme / Abnahme der Wertberichtigung auf Vorräte	811	4.505
Veränderungen von Aktiva und Passiva		
Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.866	4.427
Abnahme / Zunahme der Vorräte	15.047	-21.231
Abnahme / Zunahme des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	100	234
Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva	-5.895	-709
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.543	-4.233
Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	-10.106	-14.665
Abnahme / Zunahme der Pensionsverbindlichkeiten	-243	-491
Abnahme / Zunahme der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-2.721	1.783
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.100	3.172
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.935	-12.810
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-139	-1.643
Erwerb von Zahlungsmitteln aus / Auszahlungen für Unternehmenserwerb	-3.356	1.305
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	203	72
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.227	-13.076
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von Bankdarlehen	5.677	1.345
Tilgung von Bankdarlehen	-2.666	-2.975
Abnahme / Zunahme von Kontokorrentverbindlichkeiten	-25.991	2.362
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-844	-342
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	34.465	0
Einzahlungen aus Ausübung von Bezugsrechten	317	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	-1.376	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.582	390
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	9.455	-9.514
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	-239	125
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	7.698	16.848
Finanzmittelbestand zum Jahresende	16.914	7.459

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses

TEUR	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2001- 31.12.2001
Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung		
Zinszahlungen während der Periode	1.103	2.368
Einkommensteuerzahlungen während der Periode incl. Vorauszahlungen	3.304	16.788
Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten		
Kapitalerhöhung zum Unternehmenserwerb	0	10.682
Zugang zum Finanzierungsleasing	710	2.804
Zur Darstellung der erworbenen Vermögensgegenstände und Schulden aus den erworbenen Unternehmen wird auf den Anhang Nr. II.6 verwiesen.		

ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS (ANLAGENGITTER)

TEUR	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten						31.12.2002
	01.01.2002	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Zugang aus Unterneh- menserwerb	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.765	-586	139	246	-225		15.339
2. Goodwill	40.581						40.581
	56.346	-586	139	246	-225	0	55.920
II. Sachanlagen							
1. Gebäude, Grundstücke	7.989	-316	314		118	205	7.900
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.198	-1.665	402		-351	1.059	10.525
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.859	-415	2.163	250	458	434	13.881
4. Fahrzeuge	740	-32	9			78	639
5. Anlagen im Bau	57	-9	47				95
6. Aktivierte Leasinggegenstände							
Gebäude, Grundstücke, Einbauten	600						600
Technische Anlagen und Maschinen	833		518		-418		933
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	870		192		430	195	1.297
	36.146	-2.437	3.645	250	237	1.971	35.870
III. Finanzanlagen							
1. Equity-konsolidierte Beteiligungen	2.186		1*)				2.187
2. Übrige Beteiligungen	308					106**)	202
	2.494	0	1	0	0	106	2.389
	94.986	-3.023	3.785	496	12	2.077	94.179

*) Zugang aus Equity Bilanzierung

***) Änderung im Konsolidierungskreis

AfA 01.01.02	Abschreibungen					Restbuchwerte		
	Währungs- differenz	Zugang	Zugang aus Unterneh- menserwerb	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgänge	31.12.2002	31.12.2001	31.12.2002
3.696	-140	2.200		-96		5.660	12.069	9.679
12.572						12.572	28.009	28.009
16.268	-140	2.200	0	-96	0	18.232	40.078	37.688
2.064	-87	949		33	85	2.874	5.925	5.026
6.051	-725	1.292		-279	1.055	5.284	7.147	5.241
7.320	-316	1.871		282	416	8.741	4.539	5.140
576	-26	62			44	568	164	71
							57	95
130				60		190	470	410
530		352		-323		559	303	374
720		195		335	188	1.062	150	235
17.391	-1.154	4.721	0	108	1.788	19.278	18.755	16.592
2.073						2.073	113	114
168						168	140	34
2.241	0	0	0	0	0	2.241	253	148
35.900	-1.294	6.921	0	12	1.788	39.751	59.086	54.428

| KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Comprehensive Income	Total
Stand 01.01.2001	13.459	13.459	34.995	433	13.496	78	62.461
Erwerb Image Technology Inc.	343	343	10.186				10.529
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten			1.535				1.535
Jahresüberschuss					21.079	-247	21.079
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt							-247
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung, nach Steuereffekt						-1	-1
Stand 31.12.2001	13.802	13.802	46.716	433	34.575	-170	95.356
Einzahlung aufgrund Kapitalerhöhung	1.130	1.130	33.335				34.465
Kosten der Kapitalerhöhung nach Steuereffekt			-862				-862
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten			1.430				1.430
Einzahlungen aufgrund Ausübung von Bezugsrechten	25	25	292				317
Jahresfehlbetrag					-8.938		-8.938
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt						-3.192	-3.192
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung, nach Steuereffekt						-42	-42
Stand 31.12.2002	14.957	14.957	80.911	433	25.637	-3.404	118.534

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses

| **AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE**

	Aktien zum 30.09.02	Optionen zum 30.09.02	Aktien zum 31.12.02	Optionen zum 31.12.02
VORSTAND				
Dr. Franz Richter	400.000	65.000	400.000	65.000
Stephan Schulak	0	286	0	286
AUFSICHTSRAT				
Dr. Winfried Süß (Vors.)	1.039.780	0	1.039.780	0
Thomas Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
Dr. Christoph Schücking	500	0	500	0
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	0	0	0
Dr. Thomas Sesselmann	0	0	0	0
Horst Görtz	3.894	0	3.894	0

| **UNTERNEHMENSKALENDER**

2003

06.05.-08.05.	SEMICON Singapore, Singapore
07.05.	Quartalsbericht I/2003
06.06.	Hauptversammlung SÜSS MicroTec AG, München
14.07.-16.07.	SEMICON West/ Frontend, San Francisco
16.07.-18.07.	SEMICON West/ Backend, San Jose
05.08.	Halbjahresbericht 2003
15.09.-17.09.	SEMICON Taiwan, Taipei
04.11.	Neunmonatsbericht 2003
03.12.-05.12.	SEMICON Japan, Chiba

I ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
ZUM 31. DEZEMBER 2002

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) ist durch Umwandlung der Karl SÜSS Verwaltungs GmbH entstanden. Das Unternehmen ist ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka, Vaihingen und Singen, Deutschland, Waterbury und Palo Alto, USA, und Saint Jeoire, Frankreich. Der Standort Aßlar, Deutschland, wird im Wesentlichen als verlängerte Werkbank (vor allem Auslagerung von Montageleistungen) benutzt. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Großbritannien, Japan und Thailand. In den Ländern, in denen die Gesellschaft nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

II. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

II.1 GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Die Gesellschaft ist seit dem 18. Mai 1999 am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und am Neuen Markt der Deutsche Börse AG notiert.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften der US-amerikanischen Rechnungslegung (US-GAAP) aufgestellt. Die Gesellschaft ist als börsennotiertes Unternehmen gemäß § 292a HGB von der Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den Vorschriften der §§ 290 ff. HGB befreit. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 290 Abs. 1 ff. HGB erstellt.

Alle Angaben erfolgen in tausend EURO, sofern nichts anderes vermerkt ist.

II.2 WESENTLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HGB UND US-GAAP

Nachstehend eine Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen US-GAAP und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die für die Gesellschaft von besonderer Relevanz sind:

Sachanlagen

Bewegliche Sachanlagen werden im Konzernabschluss nach US-GAAP linear abgeschrieben, während nach deutschen Grundsätzen in Anwendung steuerlicher Vorschriften Abschreibungen auch degressiv vorgenommen werden.

Nach US-GAAP werden gemietete Grundstücke, Gebäude und betriebliche Anlagen aktiviert, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter oder über die Laufzeit des Leasingvertrages vorgenommen, je nachdem welcher kürzer ist. Die sich aus zukünftigen Leasingzahlungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen werden als Verbindlichkeiten erfasst. Nach deutschen Grundsätzen ist die buchhalterische Behandlung der Anlagegegenstände entsprechend, allerdings sind die zu erfüllenden Kriterien abweichend.

Goodwill

Nach US-GAAP wird Goodwill seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens jährlich auf Werthaltigkeit überprüft. Nach deutschem Recht wird Goodwill weiterhin planmäßig über die geschätzte Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren abgeschrieben. Eine Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt nur, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen.

Latente Steuern

Nach deutschen Grundsätzen werden aktive latente Steuerabgrenzungsposten, die von einem steuerlichen Verlustvortrag herühren, nicht angesetzt. Allein sich aus den Bewertungsunterschieden zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften ergebende aktive latente Steuerabgrenzungsposten dürfen angesetzt werden. Für die passive latente Steuerabgrenzung ist eine Rückstellung zu bilden.

Nach US-GAAP besteht eine Aktivierungspflicht für aktive latente Steuern, unabhängig ihres Ursprungs, und eine Passivierungspflicht für passive latente Steuern. Hinsichtlich des Bilanzausweises als kurz- und langfristig folgen diese Abgrenzungsposten der Klassifizierung derjenigen Posten, die zu den Bewertungsunterschieden Anlass gaben. Aktive latente Steuerabgrenzungsposten werden daraufhin untersucht, ob die Realisierung dieser Posten wahrscheinlich ist und, falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

Sonstige Rückstellungen

Nach US-GAAP sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nur zu bilden, wenn mit dem Eintritt der Verpflichtung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist und der Verpflichtungsbetrag hinreichend sicher geschätzt werden kann. Nach deutschen Grundsätzen sind Rückstellungen auch dann zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme gerechnet wird, d.h. diese hinlänglich wahrscheinlich ist.

Pensionsrückstellungen

Nach US-GAAP werden die entstandenen Rentenverpflichtungen nach dem Ansammlungsverfahren der „Projected Unit Credit“ Methode berechnet. Dabei wird der rückstellungspflichtige Barwert der Pensionsverpflichtung von Jahr zu Jahr um den Barwert des von den Arbeitnehmern hinzuverdienten Anspruchs erhöht. Berechnungsgrundlage für diese jährlichen Pensionskosten ist der Barwert der erdienten Pensionsanwartschaft unter Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltsanpassungen. Der Abzinsungssatz basiert auf dem langfristigen Zinssatz.

Nach deutschen Grundsätzen werden Rückstellungen für Pensionsverbindlichkeiten der Mitarbeiter, die am Abschlussstichtag existieren, gemäß dem steuerlichen Teilwertverfahren ermittelt. Angleichungen für zukünftige Lohn- und Gehaltssteigerungen bleiben unberücksichtigt. Die Verbindlichkeiten werden vollständig als Leistungspflicht gemäß versicherungsmathematischer Bewertung im Hinblick auf Rentenalter, Lebenserwartung und anderer Faktoren unter Verwendung eines festen Jahreszinssatzes von üblicherweise 6% angesetzt.

Fremdwährungsumrechnung

Nach US-GAAP werden Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden erfolgswirksam behandelt. Nach deutschen Grundsätzen gilt für Fremdwährungsforderungen das Niederstwertprinzip und für Fremdwährungsverbindlichkeiten das Höchstwertprinzip. Daraus folgt, dass nur unrealisierte Verluste erfolgswirksam antizipiert werden, während unrealisierte Gewinne aus Wechselkursentwicklungen zum Bilanzstichtag unberücksichtigt bleiben.

II.3 WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN NACH US-GAAP

Derivative Finanzinstrumente

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) NO. 133 „Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities“. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen Vermögensgegenständen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Marktwertänderungen werden

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

grundsätzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten sowohl Bankguthaben als auch kurzfristige Kapitalanlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als drei Monaten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen.

Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen gegenüber einzelnen Kunden.

Wertpapiere

Wertpapiere und Beteiligungen werden mit Marktpreisen bewertet, sofern diese verfügbar sind. Unrealisierte Gewinne und Verluste von Wertpapieren, die nicht langfristig gehalten werden („available for sale“) werden unter Berücksichtigung von Steuern im übrigen Comprehensive Income ausgewiesen. Die sonstigen Wertpapiere werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Auf alle Wertpapiere oder Beteiligungen werden bei nicht vorübergehenden Wertminderungen Abschreibungen vorgenommen.

Vorräte

Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet. Herstellungskosten beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Für die Ermittlung der Herstellungskosten von halbfertigen und fertigen Erzeugnissen werden Einzelkosten, für alle anderen Vorräte die FIFO-Methode (first-in, first-out) für die Bewertung verwendet. Die Herstellkosten beinhalten auch Service-Umsätzen direkt zuzuordnende Kosten. Das Vorjahr wurde entsprechend umgegliedert.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer oder geminderten Verwendbarkeit ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer für die wesentlichen Anlagekategorien ist nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Außenanlagen und Mietereinbauten	10-40 Jahre
Software	3-5 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4-5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Wesentliche Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen werden, soweit sie den Wert des Anlagegegenstandes erhöhen bzw. dessen Nutzungsdauer wesentlich verlängern,

aktiviert. Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Fremdkapitalzinsen, die für einen Vermögensgegenstand während seiner Bauzeit anfallen, werden aktiviert und beginnend mit der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme über die voraussichtliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird zwischen Finanzierungsleasing und Operating Lease unterschieden. Finanzierungsleasinggegenstände werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen aktiviert bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingsschuld. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingsschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim Operating Lease erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der Leasingzahlungen im Aufwand.

Goodwill

Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmter Nutzungsdauer werden gemäß SFAS NO. 142 „Goodwill and Other Intangible Assets“ seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Goodwill wird jährlich bzw. bei Eintritt besonderer Ereignisse, die zu einer Verringerung des Marktwertes der jeweiligen Berichtseinheit (Reporting Unit) führen können, auch unterjährig einer Werthaltigkeitsprüfung (Impairment Test) unterzogen. Als Reporting Units identifizierte das Unternehmen im Wesentlichen die einzelnen Konzerngesellschaften.

Die Werthaltigkeitsprüfung des Goodwill umfasst zwei Schritte: In einem ersten Schritt wird der Marktwert einer Reporting Unit mit dem Buchwert einschließlich Goodwill verglichen. Falls der Buchwert den Marktwert einer Reporting Unit übersteigt, gilt dieses als Anzeichen für einen möglichen Wertberichtigungsbedarf des Goodwill, und es ist ein zweiter Schritt erforderlich. In diesem zweiten Schritt wird der implizite Marktwert des Goodwill einer Reporting Unit mit dem Buchwert dieses Goodwill verglichen. Der implizite Marktwert des Goodwill entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert der Reporting Unit und den auf sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Reporting Unit zugeordneten Marktwerten, ähnlich der Vorgehensweise im Rahmen einer Unternehmensakquisition gemäß SFAS NO. 141. Unterschreitet der implizite Marktwert den Buchwert dieses Goodwill, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen.

Im Rahmen der erstmaligen Anwendung von SFAS NO. 142 führte das Unternehmen den Goodwill-Impairment Test durch, der zu keiner Wertberichtigung des Goodwill führte.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmter Nutzungsdauer werden seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Diese Vermögensgegenstände werden jährlich – bzw. im Falle von Ereignissen, die auf eine Wertminderung hindeuten können – auch unterjährig auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Der Impairment Test für immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmbarer Nutzungsdauer basiert auf einem Vergleich des Marktwertes mit dem Buchwert des immateriellen Vermögensgegenstands. Sollte der Buchwert den Marktwert übersteigen, wird eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung gebucht.

Immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauer werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögensgegenstände

Entsprechend den Vorschriften des SFAS NO. 144 „Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets“ überprüft der Konzern langfristiges Vermögen und bestimmte immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauer auf Werthaltigkeit, sobald Ereignisse oder veränderte Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögensgegenstandes oder einer Gruppe von Vermögensgegenständen den beizulegenden Wert überschreiten könnte.

I ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die Werthaltigkeit des langfristig genutzten Vermögens wird durch Vergleich des Buchwertes mit den zukünftig aufgrund dessen Nutzung erwarteten Netto-Cash Flow beurteilt. Ist ein Vermögensgegenstand oder eine Gruppe von Vermögensgegenständen nicht mehr werthaltig, so wird die vorzunehmende Abschreibung als Unterschied zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Marktwert bestimmt. Sachanlagen, die gemäß den Voraussetzungen als zum Verkauf bestimmt gelten, werden zum niedrigeren Wert aus Buchwert und Marktwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet.

Pensionsverpflichtungen

Die Pensionsverpflichtungen werden bilanziert gemäß SFAS NO. 87, „Employers Accounting for Pensions“. Die Verpflichtungen, die sich aus den Plänen der deutschen Gruppengesellschaften ergeben, werden mittels der „Projected Unit Credit“ Methode berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt.

Other Comprehensive Income

US-GAAP erfordern die Darstellung von Other Comprehensive Income innerhalb des Konzernabschlusses. Other Comprehensive Income wird dabei folgendermaßen definiert:

Alle Veränderungen des Eigenkapitals innerhalb des Geschäftsjahres, die nicht durch Anteilseigner verursacht sind und gewöhnlich nach US-GAAP nicht in den Jahresabschluss eingehen. Solche Vorgänge betreffen unter anderem Fremdwährungsanpassungen, bestimmte unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren und den über die ansetzbaren immateriellen Vermögensgegenstände hinausgehenden Teil der Mindestverpflichtung aus Pensionsverpflichtungen.

Aktienoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus Aktienoptionsplänen nach SFAS NO. 123, „Accounting for Stock-Based Compensation“, unter Anwendung der Fair-Value-Methode.

Ergebnis pro Aktie (EPS-Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach SFAS NO. 128, „Earnings per Share“.

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird. Die im Jahr 2001 und 2002 ausgegebenen Aktien wurden ab dem Zeitpunkt des Unternehmenserwerbes bzw. der Ausgabe einbezogen.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wurde ermittelt, indem der Jahresüberschuss durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wurde.

Umsatzrealisierung

Das Unternehmen wendet Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 101, „Revenue Recognition in Financial Statements“, an.

Umsätze aus Produktverkäufen werden mit Eigentumsübergang an den Kunden realisiert, wenn das Entgelt vertraglich festgesetzt oder bestimmbar und die Erfüllung der damit verbundenen Forderungen wahrscheinlich ist. Umsätze werden erst nach erfolgter Abnahme durch den Kunden realisiert. Soweit die noch zu erbringenden Leistungen nach der Lieferung wesentlich im Sinne des Auftrages sind, erfolgt eine Realisierung erst nach vollständig erbrachter Leistung.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert.

Frachten und Provisionen

Ausgangsfrachten und Provisionszahlungen an Dritte werden, soweit sie mit dem Verkauf und Vertrieb der Produkte verbunden sind, als Umsatzschmälerung ausgewiesen. Eingangsfrachten für erworbene Produkte im Herstellungsprozess werden den Herstellkosten zugeordnet. Provisionszahlungen an Mitarbeiter des Konzerns werden in den allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten ausgewiesen.

Aufwendungen für Werbung, Forschung & Entwicklung

Aufwendungen für Werbung, Forschung & Entwicklung werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet. Das Vorjahr wurde entsprechend umgliedert. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Steuern

Das Unternehmen wendet SFAS NO. 109 „Accounting for Income Taxes“ an. Nach der „Liability-Method“ werden dabei für künftige Steuerzahlungen, die sich aus den Unterschieden von Vermögensgegenständen und Schulden zwischen US-GAAP und lokalen steuerlichen Vorschriften ergeben, aktive latente Steuerabgrenzungsposten sowie Rückstellungen für latente Steuern gebildet. Dabei werden die jeweils gültigen bzw. erwarteten Steuersätze (aktuelle Rechtslage) angewendet, die zum Zeitpunkt der Aufhebung dieser Unterschiede gelten.

Verlustvorträge werden ebenfalls aktiviert und auf ihre zukünftige Realisierbarkeit untersucht. Falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

Der jeweils verwendete Durchschnittssteuersatz wird in der Überleitungsrechnung dargestellt. Hierzu verweisen wir auf V.2. Nur für 2003 erhöht sich der Körperschaftsteuersatz aufgrund des Flutopfersolidaritätsgesetzes von 25% auf 26,5%. Die Effekte wurden bei der Berechnung der latenten Steuern berücksichtigt. Die Auswirkung dieser Änderung auf den Abschluss 2002 war unwesentlich.

Bilanzierung von Zuschüssen

Bei der Bilanzierung von Zuschüssen wird zwischen Investitionszuschüssen und Zuschüssen für Forschungs- und Entwicklungskosten bzw. anderen Aufwandszuschüssen unterschieden. Investitionszuschüsse werden bei Zahlungseingang direkt von den Anschaffungskosten der erworbenen Anlagegüter abgezogen. Die anderen Zuschüsse werden bei Zahlungseingang erfolgswirksam unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen.

Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen verlangt Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung, die die im Konzernabschluss aufgeführten Beträge beeinflussen. Die tatsächlichen Werte können von den geschätzten Beträgen abweichen.

II.4 KONSOLIDIERUNG

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20% und 50%), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik ausüben kann, werden nach der Equity-Methode bewertet.

Andere Beteiligungen und Unternehmen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Unternehmenszusammenschlüsse

Seit dem 1. Juli 2001 wendet das Unternehmen das Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 141 „Business Combinations“ an. Danach werden sämtliche Unternehmenszusammenschlüsse nach der Erwerbsmethode (Purchase Method) bilanziert, d.h., die erworbenen Vermögensgegenstände und übernommenen Schulden werden zu Marktwerten (fair values) angesetzt. Ein nach anteiliger Aufdeckung stiller Reserven und Lasten verbleibender positiver Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und neu bewerteten Vermögensgegenständen und Schulden wird in der Bilanz als Firmenwert (Goodwill) aktiviert. Ist der Zeitwert des übernommenen Reinvermögens höher als die Anschaffungskosten, ergibt sich ein negativer Goodwill nur insoweit, als dieser nach Abstockung der Wertansätze bestimmter langfristiger Vermögenswerte verbleibt. Dieser Badwill wird im Erwerbsjahr als außerordentlicher Ertrag erfasst. Beim Erwerb von Gesellschaften, die nach der Equity-Methode bewertet werden, werden die oben genannten Grundsätze analog angewendet.

Transaktionen in Fremdwährungen

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Tageskurs umgerechnet. Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam als Aufwand oder Ertrag im Fremdwährungsergebnis gebucht.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die funktionale Währung des Konzerns ist der EURO. Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu gewogenen Durchschnittskursen.

	2002		2001	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 EUR	1,00	1,00	1,00	1,00
1 EUR vs 1 USD	1,04	0,95	1,13	1,12
1 EUR vs 100 JPY	124,20	118,10	86,46	92,05
1 EUR vs 1 GBP	0,62	0,63	0,61	0,62
1 EUR vs 1 CHF	1,45	1,47	n/a	n/a

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (OCI-Other Comprehensive Income) ausgewiesen.

II.5 ANGABEN ZUM KONSOLIDIERUNGSKREIS

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2002 sind folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresüberschuss der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung; (*) = ungeprüft):

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MICROTEC AG, Garching	14.956.884,00 €	Holding	99.788.889,87 €	1.655.717,25 €	
SÜSS MICROTEC LITHOGRAPHY GMBH, Garching	2.000.100,00 €	100%	24.399.355,00 €	-1.681.756,98 €	voll
SÜSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH, Sacka	511.281,88 €	100%	7.890.484,51 €	967.381,64 €	voll
SÜSS MICROTEC LAB. EQUIPMENT GMBH, Singen (*)	26.000,00 €	100%	-2.053.282,00 €	-2.192.323,00 €	voll
SÜSS MICROTEC LTD., Wokingham Berkshire (*)	£10.000,00	100%	£1.411.051,00	£87.022,00	voll
SÜSS MICROTEC KK, Yokohama	30.000,00 T.JPY	100%	451.358,28 T.JPY	-396.409,87 T.JPY	voll
SÜSS MICROTEC S.A., St. Jeoire	1.275.000,00 €	100%	2.569.884,00 €	-590.177,00 €	voll
SÜSS MICROOPTICS S.A., Neuchatel (*)	500.000,00 CHF	85%	478.216,77 CHF	-21.783,23 CHF	voll
SÜSS MICROTEC INC., Waterbury	\$105.000,00	100%	\$18.908.548,00	\$5.505.848,00	voll
IMAGE TECHNOLOGY INC., Palo Alto	\$24.287,00	100%	\$901.580,00	\$76.038,44	voll
MHI TECHNOLOGIES Group (*)	\$2.737.476,00	100%	-\$3.439.148,00	\$2.412.873,00	voll
HUGLE LITHOGRAPHY INC., Sunnyvale (*)	\$1.190.412,00	53,1%	n/a	n/a	at equity
SÜSS MICROTEC COMP. LTD, Bangkok (*)	4.000,00 THB	49%	9.984,85 THB	934,95 THB	at equity
KARL SÜSS GESCHÄFTSFÜHRUNGSG-MGBH, Garching (*)	50.000,00 €	100%	41.121,00 €	-10.266,68 €	at cost
Zentrum für Technologie-strukturentwicklung, Claubitz (*)	51.129,19 €	10%	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand (*)	n/a	10%	n/a	n/a	keine

II.6 UNTERNEHMENSERWERBE

Betrieb der B.L.E. GmbH, Singen

Mit Kaufvertrag vom 16. Januar 2002 erwarb die Karl SÜSS GmbH den Geschäftsbetrieb der in Insolvenz befindlichen B.L.E. GmbH, Singen. Die Anschaffungskosten betragen 3.356 TEUR. Mit der folgenden Aufnahme operativer Geschäftstätigkeit wurde die Karl SÜSS GmbH nebst Sitzverlegung in SÜSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH, Singen, umbenannt. Die ehemalige Karl SÜSS GmbH wird daher seit dem 01.01.2002 voll konsolidiert.

Aufteilung der erworbenen Vermögensgegenstände:

	Wert TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	250
Sachanlagen	246
Vorräte	2.860
Gesamt	3.356

Durch den Kauf des Betriebs erwarb das Unternehmen alle Rechte an Produkten der Linie Spin Coater. Diese stellen eine strategische Ergänzung des Produktportfolios dar und ersetzen teilweise die eigenen manuellen Spin Coater, da die erworbenen Produkte ein besseres Marktpotenzial aufweisen.

Auf eine pro forma-Rechnung wird verzichtet, da der Insolvenzverwalter keinen Jahresabschluss für das Vorjahr erstellt hat. Die nachträgliche Aufstellung des Vorjahresabschlusses wäre für das Unternehmen mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden.

Image Technology Inc., Palo Alto (2001)

Gemäß Vertrag vom 12. März 2001 haben die Gesellschafter der Image Technology, Inc. sämtliche von ihnen gehaltenen Anteile (Aktien 24.287 zu 1,00 USD je Stück) als Sacheinlage gegen Gewährung von insgesamt 343.256 Aktien zu 1,00 EUR der SÜSS MicroTec AG eingebracht (Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital). Die Anzahl der Aktien wurde vertragsgemäß aus dem festgesetzten Kaufpreis in Höhe von USD 9.562.213,00 abgeleitet.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die Vermögensgegenstände und Schulden in der Eröffnungsbilanz zum 12. März 2001 stellen sich wie folgt dar:

	Wert TEUR
Umlaufvermögen	1.175
Anlagevermögen	4.648
Liquide Mittel	1.305
Aktiva	7.128
Verbindlichkeiten	3.998
Eigenkapital	3.130
Passiva	7.128
entstandener Goodwill	7.399

Die Gesellschaft wurde ab dem 12. März 2001 als Tochtergesellschaft in den Konzernabschluss einbezogen. Der dabei entstandene Goodwill wurde bis 31. Dezember 2001 über 10 Jahre abgeschrieben, die identifizierten immateriellen Gegenstände werden dagegen in 5 Jahren abgeschrieben. Die im folgenden dargestellte ungeprüfte pro forma-Zusammenfassung zeigt das konsolidierte Gruppenergebnis unter der Annahme, dass die erworbene Gesellschaft ab dem 1. Januar 2001 in das Gruppenergebnis einbezogen wurde. Der Beginn der Abschreibung des Goodwill wurde ebenfalls mit Beginn des Jahres 2001 angenommen.

2001 pro forma	Wert TEUR
Umsatz	215.804
Betriebsergebnis	39.766
Ergebnis nach Steuern	20.888
Ergebnis je Aktie unverwässert EUR	1,51
Ergebnis je Aktie verwässert EUR	1,51

II.7 NEUE RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

SFAS NO. 143 – Accounting for Asset Retirement Obligations

Im Juni 2001 hat das FASB SFAS NO. 143 „Accounting for Asset Retirement Obligations“ herausgegeben. Dieser Standard ist auf rechtliche Verpflichtungen anzuwenden, die im Zusammenhang mit dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens entstehen und aus der Anschaffung, der Konstruktion, der Entwicklung und (oder) dem geschäftsüblichen Betrieb der Anlagen resultieren. Hiervon ausgenommen sind bestimmte Verpflichtungen von Leasingnehmern. SFAS NO. 143 schreibt vor, dass der Zeitwert einer Verpflichtung aus dem Abgang von Anlagevermögen in der Periode anzusetzen ist, in der die Verpflichtung entsteht, wenn eine zuverlässige Schätzung des Zeitwertes möglich ist. Die mit dem Abgang anfallenden Aufwendungen werden als Bestandteil der Anschaffungskosten der Anlage aktiviert und über deren Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Konzern wird SFAS NO. 143 zum 1. Januar 2003 anwenden. SÜSS MicroTec erwartet derzeit keine Auswirkungen aus der Anwendung von SFAS NO. 143.

SFAS NO. 146 – Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities

Im Juli 2002 veröffentlichte das FASB SFAS NO. 146 „Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities“. Das Statement erfordert, dass Verpflichtungen für Kosten in Zusammenhang mit Beendigungs- oder Veräußerungsvorgängen in der Periode angesetzt werden, in der die Kosten entstanden sind, sofern eine vernünftige Schätzung des Zeitwertes vorgenommen werden kann. Bisher konnten solche Verpflichtungen bereits angesetzt werden, wenn sich das Management zu einem Restrukturierungsplan (selbst) verpflichtete. Die Erfordernisse gemäß SFAS NO. 146 gelten prospektiv für Beendigungs- oder Veräußerungsvorgänge, die nach dem 31. Dezember 2002 initiiert werden. Die rückwirkende Anpassung von Abschlüssen früherer Perioden ist nicht erlaubt. Die Anwendung dieses Statements wird die Abschlüsse des Konzerns für solche Beendigungs- oder Veräußerungsvorgänge beeinflussen, die nach dem 31. Dezember 2002 initiiert werden.

SFAS NO. 148 – Accounting for Stock-Based Compensation

Im Dezember 2002 hat das FASB den Bilanzierungsstandard SFAS NO. 148 "Accounting for Stock-Based Compensation-Transition and Disclosure – an amendment of FASB Statement No. 123" verabschiedet. Dieser Standard ergänzt SFAS NO. 123 „Accounting for Stock-Based Compensation“ um alternative Übergangsvorschriften bei einer freiwilligen Erstanwendung der auf Marktwerten basierenden Bilanzierung von aktienorientierter Vergütung. Darüber hinaus sieht SFAS NO. 148 bei der Bilanzierung aktienorientierter Vergütung für alle (auch unterjährigen) Abschlüsse zusätzliche Anhangangaben an hervorgehobener Stelle zur angewendeten Bilanzierungsmethode und zu den daraus resultierenden Ergebniseffekten vor. Das Unternehmen wendet bereits die Fair Value Methode nach SFAS NO. 123 an und rechnet mit keinen wesentlichen Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung.

FIN 45

Im November 2002 hat das FASB die Interpretation (FIN) 45 „Guarantor’s Accounting and Disclosure Requirements for Guarantees, Including Indirect Guarantees of Indebtedness of Others – an interpretation of FASB statements 5, 57, and 107 and rescission of FASB interpretation 34“ herausgegeben. Diese Interpretation verdeutlicht die Angabepflichten, die ein Garantiegeber in seinem Abschluss zu den Verpflichtungen aus diesen von ihm gewährten Garantien zu machen hat. FIN 45 stellt zudem klar, dass ein Garantiegeber zum Zeitpunkt der Garantiezusage eine Passivierung in Höhe des Zeitwerts für die Verpflichtung vorzunehmen hat, die ihm aus der Gewährung der Garantie entstanden ist. Die Angabepflichten sind in Zwischenberichten und Konzernabschlüssen für alle Perioden vorgeschrieben, die nach dem 15. Dezember 2002 enden. Für die geforderten Anhangangaben verweisen wir auf IV.5.

Die Ansatzvorschriften gelten für Garantien bzw. Haftungsverhältnisse, die nach dem 31. Dezember 2002 gewährt bzw. modifiziert wurden. Das Unternehmen untersucht derzeit die Auswirkungen der Ansatz- und Bewertungsvorschriften von FIN 45 auf den Konzernabschluss.

FIN 46

Im Januar 2003 hat der FASB die Interpretation (FIN) 46 „Consolidation of Variable Interest Entities“ veröffentlicht. Mit dieser Interpretation soll die Frage geklärt werden, wann eine Gesellschaft in Form der Zweckgesellschaft (Variable Interest Entity-VIE) zu betrachten ist und wann die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Minderheitsbeteiligungen und Betriebsergebnisse einer VIE im Konzernabschluss eines Unternehmens auszuweisen sind. Die Gesellschaft erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

III. Erläuterungen zu den Bilanzaktiva (Werte in Tausend EUR)

III.1 MARKTWERTE DER FINANZINSTRUMENTE

Die geschätzten Marktwerte der nicht-derivativen Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde.

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Flüssige Mittel: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Langfristige Darlehen: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten wird durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt. Derivative Instrumente sind zu Marktwerten gemäß den Bankmitteilungen angesetzt.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Marktwerte der Finanzinstrumente, die sowohl Aktiv- als auch Passivpositionen der Bilanz betreffen:

	2002		2001	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Flüssige Mittel	16.914	16.914	7.459	7.459
Forderungen	34.105	34.105	50.804	50.804
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3.531	-3.531	-29.522	-29.522
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. kurzfristiger Teil)	-18.017	-18.813	-15.036	-14.137
Gesamt	29.441	28.645	13.705	14.604

III.2 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen.

Das Unternehmen sichert folgende Risiken durch den Abschluss von Devisentermingeschäften ab:

Absicherung konzerninterner Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des USD und des YEN, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem EURO-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Absicherung konzerninterner Darlehen

Von der Muttergesellschaft gewährte Darlehen an Tochtergesellschaften werden üblicherweise in der funktionalen Währung der Tochtergesellschaft ausgereicht und von dieser auch in dieser Währung getilgt. Um für die Muttergesellschaft das Risiko der Wertänderungen abzusichern, werden auf Basis des Tilgungsplanes die Zahlungsleistungen abgesichert.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt. Zum Jahresende 2002 bestanden folgende Devisentermingeschäfte:

	Nominalvol.	Marktwerte
Verkauf von US - Dollar (in TUSD)	3.093	517
...davon bis zu einem Jahr	2.693	450
... davon bis Jahr 2004	400	67
Kauf von US - Dollar (in TUSD)	155	-11
...davon bis zu einem Jahr	155	-11

Diese Kontraktwerte stellen die Summe der zum 31. Dezember 2002 bestehenden Verpflichtungen aus Devisentermingeschäften dar. Die potentiellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

III.3 FLÜSSIGE MITTEL

Änderungen bei den Bankverbindlichkeiten werden im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Das Vorjahr wurde entsprechend umgegliedert.

	2002	2001
Flüssige Mittel	16.914	7.159
...davon kurzfristige Geldanlagen	4.369	0

III.4 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

	2002	2001
Forderungen gegen Dritte	35.628	52.194
Wertberichtigungen	-1.523	-1.690
Forderungsbestand netto	34.105	60.804

III.5 SONSTIGE KURZFRISTIGE FORDERUNGEN

Mit Vertrag vom 7. August 2001 wurden die restlichen Forderungen aus der Übertragung der Eigentumsrechte an den Patenten und der Technologie betreffend die Röntgenlithographie der SUSS MicroTec, Inc. und der SUSS MicroTec Lithography GmbH im Jahr 1998 an die JMAR Technologies, Inc. veräußert. Der Gegenwert wurde in einer Höhe von USD 267.000,00 und 60.000 Anteilen zu 0,01 USD je Stück an der JMAR Technologies, Inc. geleistet. Der Verkaufserlös wurde unter den sonstigen Erträgen bilanziert und die Aktien als „available for sale“ in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen, da die Absicht besteht, diese kurzfristig zu veräußern.

Bei dem Aktienbestand der JMAR-Aktien wurde eine dauerhafte Wertminderung in Höhe von TEUR 140 erfolgswirksam gebucht. Der verbleibende Buchwert in den sonstigen Vermögensgegenständen beträgt zum Jahresende TEUR 63 (2001: TEUR 203).

In den sonstigen kurzfristigen Forderungen sind folgende Positionen enthalten:

	2002	2001
Umsatzsteuer	429	701
Devisentermingeschäfte	505	20
Geleistete Anzahlungen	476	168
Körperschaftsteuervorauszahlung	5.560	66
Sonstiges	2.279	2.589
Sonstige kurzfr. Aktiva	9.249	3.544

III.6 VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

	2002	2001
Materialien und Hilfsstoffe	21.445	33.613
Unfertige Erzeugnisse	12.154	13.428
Fertigerzeugnisse	8.965	7.442
Demonstrationsgeräte	11.981	8.699
Handelswaren	410	3.960
Wertberichtigungen	-8.893	-6.082
Vorräte netto	48.062	61.060

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Kein Vorratsvermögen (2001: TEUR 18.657) ist zur Sicherung von Krediten verpfändet, da die entsprechende Kreditlinie derzeit neu verhandelt wird.

III.7 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

III.8 SACHANLAGEN

Für die Darstellung der Sachanlagen verweisen wir auf den beigefügten Anlagenspiegel.

	2002	2001
Abschreibung auf Sachanlagen	4.721	3.387

Kein Sachanlagevermögen ist zur Sicherung von Krediten (2001: TEUR 1.432) verpfändet, da die entsprechende Kreditlinie derzeit neu verhandelt wird.

Leasing

Das Unternehmen hat bestimmte Sachanlagen über langfristige Mietverträge angemietet. Diese Verträge stellen aufgrund ihrer Charakteristika Finanzierungsleasing dar und werden entsprechend buchhalterisch behandelt. Zur detaillierten Darstellung verweisen wir auf den Anlagenspiegel und auf IV.2.. Daneben mietet das Unternehmen Gebäude, Büroeinrichtungen und Fahrzeuge, die Operating Lease darstellen.

III.9 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UND GOODWILL

Entsprechend den Regelungen des SFAS NO. 142 wird Goodwill in Höhe von 28 Mio. EUR seit dem 1. Januar 2002 nicht länger planmäßig abgeschrieben.

Im Zusammenhang mit der Erstanwendung von SFAS NO. 142 wurden im Mai 2002 die Nutzungsdauern aller erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände überprüft. Dabei wurden keine immateriellen Vermögensgegenstände festgestellt, die eine unbestimmbare Nutzungsdauer haben.

Die erstmalige Anwendung von SFAS NO. 142 verlangte, dass alle im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen vor dem 1. Juli 2001 erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände, welche die in SFAS NO. 141 beschriebenen Voraussetzungen für einen separaten Ausweis nicht erfüllen, als Goodwill zu reklassifizieren sind. Ebenso sind immaterielle Vermögensgegenstände, welche die Kriterien für einen separaten Ausweis erfüllen, bisher aber als Goodwill aus der Erstkonsolidierung erfasst waren, als immaterielle Vermögensgegenstände auszuweisen. Das Unternehmen stellte in diesem Zusammenhang keinen Bedarf an Reklassifikationen fest.

Die erforderliche jährliche Überprüfung des Goodwill auf Wertminderung wird jeweils im 3. Quartal eines Geschäftsjahres bzw. bei Eintritt besonderer Ereignisse vorgenommen.

In folgender Tabelle werden die Auswirkungen aus der Erstanwendung von SFAS NO. 142 zum 1. Januar 2002 auf den Konzernüberschuss sowie auf das Ergebnis je Aktie gezeigt, als wären diese Regelungen bereits am 1. Januar 2001 in Kraft getreten:

	2001 pro forma	2001 wie berichtet
Jahresüberschuss	25.423	21.079
enthaltene Goodwill-Abschreibung	0	4.344
Ergebnis je Aktie unverwässert EUR	1,85	1,53
Ergebnis je Aktie verwässert EUR	1,84	1,53

Eine Veränderung des Goodwills erfolgte durch die Neuregelungen nicht. Für die Zusammensetzung der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2002 verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden weder im Geschäftsjahr 2002 noch in 2001 vorgenommen.

	2002	2001
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	6.140
... davon auf Goodwill	0	4.344

Auf Basis des Bestands an immateriellen Vermögensgegenständen, die ausnahmslos eine bestimmbare Nutzungsdauer haben, werden die folgenden Abschreibungsbeträge für die folgenden fünf Berichtsjahre erwartet:

	Wert TEUR
2003	2.261
2004	2.034
2005	1.877
2006	1.332
2007	1.209
... Später	966

Diese Schätzungen können von den tatsächlichen Beträgen in der Zukunft abweichen.

III.10 FINANZANLAGEN

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	2002	2001
Equity-konsolidierte Beteiligungen	114	113
Übrige Beteiligungen	34	140
Finanzanlagen	148	253

Mittels der Equity-Methode wurde die Beteiligung an der Hugel Lithography Inc., USA (Anteil 53,1%) bewertet. Die Beteiligung wurde zum 31. Dezember 2002 mit ihrem anteiligen Eigenkapital in Höhe von TEUR 22 (Vorjahr TEUR 22) bilanziert. Die Geschäftstätigkeit war in 2002 immateriell.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die 49%-Beteiligung an der SÜSS MicroTec Asia Company Ltd., Bangkok, wurde ebenfalls mittels der Equity-Methode bewertet. Es ergab sich eine Erhöhung des Beteiligungsansatzes auf TEUR 92 (Vorjahr TEUR 91). Angaben zum Unternehmen in tausend BAHT:

	2002	2001
Umsätze	30.321	31.155
Aufwendungen	29.146	30.494
Steuern	240	213
Ergebnis nach Steuern	936	448

Umlaufvermögen	5.217	2.744
Anlagevermögen	6.727	7.945
Aktiva	11.944	10.689
Verbindlichkeiten	1.960	1.727
Eigenkapital	9.984	8.962
Passiva	11.944	10.689

Daneben bestehen weitere Beteiligungen mit Anteilen am Aktienkapital von weniger als 20%. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.

III.11 SONSTIGE LANGFRISTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstige langfristigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen.

	2002	2001
Rückdeckungsversicherung	1.395	1.140
Kautionen	256	249
Ausleihungen	96	113
Sonstiges	193	248
Sonstige langfristige Aktiva	1.940	1.750

IV. Erläuterungen zu den Bilanzpassiva

IV.1 KURZFRISTIGE BANKVERBINDLICHKEITEN

Der durchschnittliche Zinssatz der Kreditlinien betrug 6,05%.

	2002	2001
Kreditlinie	19.431	42.406
Inanspruchnahme	3.531	29.522
Verfügbare Kreditlinie	15.900	12.884

IV.2 LEASINGVERBINDLICHKEITEN

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

	Financial Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahe stehenden Personen
Aufwendungen 2001	--	2.255	1.292
Aufwendungen 2002	--	3.183	2.140
... fällig in 2003	325	2.903	2.115
2004	184	2.300	1.761
2005	158	2.008	1.694
2006	148	1.823	1.681
2007	102	1.417	1.339
... später	178	7.860	7.856
Gesamt zukünftig	1.095	18.311	16.446
Zinsanteil	207		
Verbindlichkeit	888		
... davon kurzfristig	275		
... davon langfristig	613		

IV.3 PENSIONSVERBINDLICHKEITEN

Das Unternehmen hat verschiedene Versicherungspläne, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität versichern. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2002	2001
Inländische Verpflichtungen	3.520	3.474
... davon kurzfristig	223	239
Ausländische Verpflichtungen	283	572
... davon kurzfristig	0	274
Gesamt	3.803	4.046
... davon kurzfristig	223	513

Deutsche Pläne

Die Pensionszusagen umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2002	2001
Abzinsungsfaktor	5,5%	6,0%
Gehaltssteigerung	0,0%	0,0%
Rentensteigerung	1,0%	1,0%

Lebenserwartung gem. Richttafel Dr. Heubeck 1998

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die nachfolgende Aufstellung leitet den „funded status“ der Pläne über auf die in der Bilanz gebuchte Verbindlichkeit:

	2002	2001
Überleitung der erwarteten Pensionsverbindlichkeit		
Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 01.01	3.474	3.292
Servicekosten	3	2
Zinskosten	200	206
Versicherungsmathematischer Gewinn (Verlust)	110	241
Pensionszahlungen	-267	-267
Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 31.12.	3.520	3.474
Versicherungsmathematischer Barwert der kumulierten Pensionsverbindlichkeit (ABO) 31.12.		
	3.520	3.474
Darstellung des Bilanzwertes		
Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 31.12.	3.520	3.474
Plankapitalanlagen	0	0
Umrechnete Pensionsverbindlichkeit	3.520	3.474
Nicht realisierte Überleitungsbeiträge	-107	-142
Nicht realisierte Servicekosten früherer Perioden	-19	-23
Nicht realisierte Erträge und Verluste	-73	36
	3.321	3.345
Zusätzliche Mindestverbindlichkeit	199	129
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	126	123
... davon Other Comprehensive Income	73	6
Pensionsrückstellung	3.520	3.474
Aufstellung der Pensionsaufwendungen		
Servicekosten	3	2
Zinskosten	200	206
Amortisation der Überleitungsbeiträge	36	36
Amortisation der Servicekosten früherer Perioden	1	6
Amortisation der versicherungsmathematischen Gewinne (Verluste)	0	-3
Pensionsaufwendungen	240	247

U.S.-Pläne

Das Unternehmen hat einen „Defined Contribution Plan“, welcher im Wesentlichen sämtliche Arbeitnehmer, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, umfasst. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Der Vorstand der U.S. Gesellschaft bestimmt jährlich die Beiträge neu, die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließen. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von 6 Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2002 betragen die Aufwendungen des Unternehmens für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2001 TUSD 102) und für den 401 (k) Plan TUSD 196 (2001 TUSD 210).

IV.4 LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN

Zum 31. Dezember 2002 waren Bankdarlehen in Höhe von nominal TEUR 1.432 durch Grundschulden besichert. Für Bankdarlehen über nominal TEUR 10.175 hat die SUSS MicroTec AG ihre Anteile an der SUSS MicroTec Lithography GmbH, an der SUSS MicroTec S.A. und an der SUSS MicroTec Inc. verpfändet.

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

	2002	2001	Zinssatz	Fälligkeit
Bankdarlehen I (EUR)	4.449	5.084	3,25%	2009
Bankdarlehen II (EUR)	4.474	5.113	3,75%	2009
Bankdarlehen III (EUR)	1.865	2.904	5,45%	2003
Bankdarlehen IV (EUR)	882	1.029	3,75%	2009
Bankdarlehen V (USD) in EUR	1.518	0	8,42%	2007
Bankdarlehen VI (USD) in EUR	467	0	8,42%	2007
Bankdarlehen VII (USD) in EUR	1.514	0	9,39%	2007
Sonstige Darlehen < 1 Mio EUR	2.878	906		
Gesamt	18.047	15.036		
...davon kurzfristig fällig	3.546	2.634		
...davon langfristig fällig	14.501	12.402		

... fällig in 2003	3.546
2004	3.388
2005	2.500
2006	2.563
2007	1.989
...später	4.061
	18.047

IV.5 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Der Bilanzposten teilt sich wie folgt auf:

	2002	2001
Steuerrückstellungen	1.625	6.200
Erhaltene Anzahlungen	3.409	6.866
Abgegrenzte Personalkosten	5.606	7.644
Prämien und Provisionen	4.169	2.448
Fremdleistungen	2.400	3.319
Umsatzsteuer	2.019	396
Garantierückstellungen	1.735	2.796
Passive Rechnungsabgrenzung	593	410
Sonstiges	2.878	4.459
Summe	24.432	34.538

In den abgegrenzten Personalkosten sind TEUR 2.102 Rückstellungen für Restrukturierung (siehe VI.3) enthalten.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die Garantierückstellungen werden jährlich auf Basis der entstandenen Garantiekosten im Verhältnis zum erzielten Umsatz neu kalkuliert.

	Betrag TEUR
Stand 1. Januar 2002	2.796
Zuführung	333
Verbrauch	1.394
Stand 31. Dezember 2002	1.735

IV.6 SONSTIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

In den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

	2002	2001
Lieferantenverbindlichkeiten	351	2.515
Darlehen von Mitarbeitern	103	113
Sonstiges	281	880
Summe	736	3.608

IV.7 EIGENKAPITAL

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG beträgt EUR 15 Mio. und ist eingeteilt in 15 Mio. Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,00.

Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß dem handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Aus dem ursprünglich genehmigten Kapital in Höhe von EUR 6,5 Mio. führte der Vorstand mit Beschluss vom 17. Mai 2001 eine Kapitalerhöhung um EUR 343.256 durch. Die Aktien wurden im Rahmen des Erwerbs der Image Technologies ausgegeben. Die Kapitalerhöhung wurde am 12. September 2001 im Handelsregister eingetragen und somit rechtswirksam. Der Aufsichtsrat hat der Kapitalerhöhung zugestimmt.

Am 16. Januar 2002 wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von nominal EUR 1.130.000 gegen Bareinlage aus dem genehmigten Kapital durchgeführt. Dadurch flossen der SÜSS MicroTec Barmittel in Höhe von EUR 34.465.000 brutto zu.

Auf der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde beschlossen, das genehmigte Kapital auf 7.466.242 EUR zu erhöhen. Das bedingte Kapital von insgesamt 5.822.800 EUR kann für bis zu 5.000.000 EUR für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden; 500.000 EUR können für den neuen Optionsplan genutzt werden. Der Restbetrag von 322.800 EUR ist dem alten, geschlossenen Optionsplan zuzuordnen.

	2002	2001
Grundkapital	14.957	13.802
genehmigtes Kapital	7.466	5.698
bedingtes Kapital	5.823	800

Other comprehensive income (OCI)

Die Entwicklung des OCI stellt sich wie folgt dar:

	2002	2001
Fremdwährungsanpassungen	-166	81
Mindestverbindlichkeit Pensionen	-4	-3
OCI zu Beginn der Periode	1/0	/8
Veränderungen vor Steuern		
Fremdwährungsanpassungen	-3.192	-247
Mindestverbindlichkeit Pensionen	-67	-1
Steuereffekte		
Fremdwährungsanpassungen	0	0
Mindestverbindlichkeit Pensionen	25	0
OCI am Ende der Periode	-3.101	-170

Aktienoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu EUR 800.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. März 2004 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können zu 50% nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Jahren, zu 50% nach Ablauf einer Wartefrist von 5 Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien der SMT AG den Bezugspreis bei Ausübung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50%, nach vier Jahren um mindestens 75% bzw. nach fünf Jahren um mindestens 100% übersteigt. Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. 6 Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital für diesen Optionsplan auf EUR 350.000 gesenkt. Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde für die Zukunft aufgehoben.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde weiterhin der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren zu 100% ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn

- das Konzern-EBITDA der geprüften Abschlüsse zum Ende des letzten Geschäftsjahres vor der Ausübung des Bezugsrechtes gegenüber dem Konzern-EBITDA des Geschäftsjahres vor Einräumung des Bezugsrechtes um durchschnittlich 10% gewachsen ist und im selben Zeitraum der Börsenkurs der Aktie sich prozentual besser entwickelt hat als der NEMAX Technology-Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgeindex, oder
- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833% pro vollem Kalendermonat (10% pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechtes und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. 3 Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zu den Kapitalrücklagen in Höhe von TEUR 1.430 (2001: TEUR 1.535) für diese Pläne vorgenommen.

In 2002 wurden keine neuen Optionen gewährt. In 2001 wurden 68.000 Bezugsrechte im Mai mit einem Bezugspreis von EUR 35,44 gewährt. Am 31. Dezember 2002 bestanden 322.800 Bezugsrechte (Vorjahr 348.630 Bezugsrechte), die alle noch nicht ausgeübt werden können.

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2001 gewährten Optionen in Höhe von EUR 19,45 wurde unter Verwendung des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells geschätzt. Dabei wurden folgende Annahmen getroffen:

	2002	2001	2000 Mai	2000 Dezember	1999
Erwartete durchschnittl. Laufzeit	--	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Risikofreier Zinssatz	--	4,61%	3,30%	4,70%	3,30%
Erwartete Volatilität Süss Aktie	--	57%	150%	76%	46%
Erwartete Dividende	--	0%	0%	0%	0%

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis EUR
31.12.1998	0	
gewährt 1999	136.000	13,00
ausgeübt 1999	0	
verfallen 1999	9.600	13,00
31.12.1999	126.400	13,00
gewährt 2000	157.662	28,64
ausgeübt 2000	0	
verfallen 2000	0	
31.12.2000	284.062	21,68
gewährt 2001	68.000	35,44
ausgeübt 2001	0	
verfallen 2001	3.432	27,31
31.12.2001	348.630	24,31
gewährt 2002	0	
ausgeübt 2002	24.400	13,00
verfallen 2002	1.430	28,64
31.12.2002	322.800	25,14
ausgeübt	24.400	
noch begebbar	0	

Die Entwicklung der ausgegebenen Optionen ist in nachstehender Tabelle aufgelistet:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittl. Bezugspreis EUR	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit Monate
unter EUR 20,00	102.000	13,00	29
EUR 20,00 - EUR 24,99	--	--	--
EUR 25,00 - EUR 29,99	128.800	27,31	47
EUR 30,00 - EUR 35,99	68.000	35,44	53
ab EUR 36,00	24.000	36,00	41
	322.800	25,14	42

Ergebnis pro Aktie

Die Gesellschaft hat im Rahmen eines Aktienoptionsplans Bezugsrechte auf Aktien gewährt. Durch das Erreichen der Ausübungshürden zum Stichtag für einen Teil der Bezugsrechte ergab sich ein Verwässerungseffekt, der bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses pro Aktie berücksichtigt wurde. Es wurden keine der ausgegebenen Bezugsrechte (Vorjahr 225.662) berücksichtigt, da sie keinen verwässernden Effekt haben.

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses pro Aktie.

	2002	2001
Zähler:		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-8.938	21.079
Nenner:		
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien		
unverwässert	14.893.023	13.736.654
Verwässerung	0	68.198
verwässert	14.893.023	13.804.852
Ergebnis pro Aktie in EUR:		
unverwässert	-0,60	1,53
verwässert	-0,60	1,53

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

V.1 SONSTIGE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE

	2002	2001
Stornogebühren	581	2.643
Rückstellungsaufhebungen	1.461	895
Verkauf Patente	0	674
Versicherungseisleistungen	14	134
Mieterträge	81	17
Sonstige Zuschüsse	400	568
Sonstiges	617	107
Summe Erträge	3.154	5.018
Vertragsstrafen, Schadenersatz	32	1.000
Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-236	478
Einzelwertberichtigung	1.941	118
Abgang Anlagevermögen	289	65
Sonstige Steuern	61	59
Rückzahlung Zuschüsse	0	209
Sonstiges	1.465	111
Summe Aufwendungen	3.555	2.040
Saldo	-401	2.978

Die sonstigen Zuschüsse betreffen insbesondere erhaltene Zuschüsse der SUSS Test Systems GmbH, Dresden, für Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

V.2 STEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

	2002	2001
Deutsche Körperschaftsteuer	-2.089	3.946
Deutsche Gewerbeertragsteuer	275	2.115
Ausländische Ertragsteuer	6.053	11.995
Zwischensumme	-7.867	18.056
Inanspruchnahme/Bildung latenter Steuern auf Verlustvorträge	365	-337
Sonstiges	0	161
Gesamtertrag /-aufwand	-8.232	17.880
... davon laufend	-4.724	18.056
Inland	680	6.061
Ausland	-5.384	11.995
davon latent	3.508	176
Inland	-2.475	-896
Ausland	-1.033	520

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

	2002	2001
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	25,00%	25,00%
Solidaritätszuschlag	5,50%	5,50%
Gewerbesteuersatz	14,90%	14,90%
Kombinierter Steuersatz	37,34%	37,34%
Ergebnis vor Steuern	-17.170	38.959
erwartete Ertragssteuern	-6.411	14.548
Abweichende Steuersätze im Ausland	-1.166	1.526
Kein Ansatz latenter Steuern bei dem Verlust der MFI Technologies	0	678
Steuerlich nicht zu berücksichtigender Aufwand im Konzern für erworbene laufende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten	0	164
Nicht abzugsfähige Goodwill-Abschreibungen im Konzern	0	1.305
Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen	88	95
Abwertung von konzerninternen Darlehenspositionen	-574	-794
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	12	719
Nicht angesetzte, aber steuerlich genutzte Verlustvor- und rückträge	-674	-77
Wertberichtigung auf Verlustvorträge	453	0
Sonstiges	40	-282
Effektive Ertragssteuern	-8.232	17.880

Durch den Transfer immaterieller Vermögensgegenstände von Kanada nach Deutschland wurden wertberichtigte aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von TEUR 674 genutzt. Die konzerninternen Darlehensabwertungen würden bei der entsprechenden Tochter bei Darlehensverzicht keine Ertragssteuerzahlung verursachen, da wertberichtigte aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von TEUR 1.509 genutzt würden. Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

	Aktiva		Passiva	
	2002	2001	2002	2001
Bonusrückstellungen	162	361		
Pensionsrückstellungen	1.269	1.170		
Urlauberückstellungen	258	288		
Sonstige Rückstellungen	645	1.606		
Goodwill	5	744		
SAB 101 Anpassungen	0	354		
Zwischengewinneliminierung	3 080	1 947		
Unterschicd. Abschreibungen			1.029	1.005
Sonstiges	306	784		
Verlustvorträge	5.656	1.974		
/, Wertberichtigung Verlustvorträge	-2.032	-1.974		
Gesamt	9.329	6.749	1.029	1.005
Gesamt netto	8.300	5.744		
... davon kurzfristig	3.405	5.387		
davon langfristig	4 895	357		

V.3 NAHESTEHENDE PERSONEN

SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains (vormals SUSS Real Estate)

Verschiedene Konzerngesellschaften (SÜSS MicroTec Lithography GmbH, SUSS Dresden Test Systems GmbH, SUSS MicroTec, Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der SÜSS Grundstücksverwaltungs GbR oder der SUSS Real Estate. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Verträgen ergebenden zukünftigen Mindestleasingraten sind in IV.2 dargestellt.

	2002	2001
Mieteinnahmen	1.766	1.292

Familie Süss

Die Familie Süss als ehemalige Gesellschafter und heutige Aktionäre des Unternehmens hat Bezüge in verschiedenster Form, u.a. als Pensionsansprüche und Mietzahlungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süss dar. Die Pensionsansprüche sind in IV.3 Pensionsverpflichtungen, deutsche Pläne, dargestellt.

	2002	2001
Gehälter und Pensionen	274	267
Beratungsleistungen	43	0
Summe	317	267

CMS

Das Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Christoph Schücking ist Gesellschafter der CMS, einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Gruppe erhält Rechtsberatung von dieser Kanzlei.

	2002	2001
Beratungsleistungen	138	92

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

Leistungen an nahestehende Personen

	2002	2001
Gehälter und Pensionen	274	267
Beratungsleistungen	181	92
Mieteinnahmen	1.786	1.292
Summe	2.241	1.661

VI. Sonstige Angaben

VI.1 BESONDERE AUFWANDSPOSITIONEN

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind die im Folgenden dargestellten Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

	2002	2001
Löhne und Gehälter	44.887	48.603
Soziale Abgaben	8.413	10.678
Aufwendungen zur Altersvorsorge	961	931
Personalaufwand gesamt	54.261	60.212
Ausgaben für Werbung	2.742	2.080
Forschung und Entwicklung	12.537	16.731

Die Materialaufwendungen betragen in 2002 TEUR 47.961.

VI.2 EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

	2002	2001
Bestellobligo	2.150	3.829
Wechselobligo	0	4.556
Rückkaufgarantien	1.577	2.686
Sonstiges	166	0
Summe	3.693	11.071

Das Bestellobligo verpflichtet uns zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Bei den Rückkaufgarantien besteht bei einem Fall ein erhöhtes Risiko der Ausübung. Für diesen Fall wurde bereits eine Verbindlichkeit in Höhe von 317.380 USD eingestellt.

Die Rückkaufgarantien basieren in der Regel auf unseren eigenen Herstellkosten: Normalerweise entspricht der initiale Rückkaufpreis unseren eigenen Herstellkosten und damit nicht mehr als 60% des Verkaufspreises. Der Rückkaufpreis reduziert sich um 20% pro Jahr, und die Garantie läuft nach 3 Jahren aus.

VI.3 RESTRUKTURIERUNG

Während des Jahres 2002 erfolgte bereits ein laufender Personalabbau, der aber nicht im Rahmen eines Projektes erfolgte. Dieser Abbau beinhaltete zum Beispiel die Kündigung während der Probezeit oder der nicht erfolgte Ersatz bei einem Abgang von Mitarbeitern.

Im vierten Quartal musste aufgrund der Marktentwicklung eine Restrukturierung mit betriebsbedingten Kündigungen durchgeführt werden. Es wurde ein Plan verabschiedet und den Mitarbeitern mitgeteilt. Dabei fielen auch Zahlungen und Kosten in Form von Abfindungen und Freistellungen der Mitarbeiter an. Angaben zu der Restrukturierung sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Mitarbeiter	
Personalabbau erfolgt in 2002	
Verwaltung	8
Marketing und Vertrieb	13
Produktion und Technik	39
Forschung und Entwicklung	4
Gesamt	62
Personalabbau erfolgt in Q1/2003	
Verwaltung	12
Marketing und Vertrieb	14
Produktion und Technik	72
Forschung und Entwicklung	14
Gesamt	112
Personalabbau gesamt	
Verwaltung	18
Marketing und Vertrieb	27
Produktion und Technik	111
Forschung und Entwicklung	18
Gesamt	174
Restrukturierungskosten in TEUR	
gezahlt in 2002	308
zu zahlen in 2003	2.102
Gesamt	2.410

Es wurden keine Geschäftsaktivitäten eingestellt. Auch wurde durch den Mitarbeiterabbau keine Abwertung von langfristigen Vermögensgegenständen in den einzelnen Unternehmenseinheiten erforderlich. Dies ist dadurch begründet, dass die Aktivitäten überwiegend den Zusammenbau von Teilen darstellen, wofür keine wesentlichen Anlagen erforderlich sind.

Entwicklung der Rückstellung in 2002:

	Wert TEUR
Bestand 01.01.2002	0
Zuführung	2.410
Verbrauch	308
Bestand 31.12.2002	2.102

Die Aufwendungen zur Zuführung der Rückstellung wurden den entsprechenden Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung zugeordnet.

VI.4 SEGMENTSBERICHTERSTATTUNG

Die Gruppe ist mit dem Verkauf von technischen Produkten und Service nur in einem Segment tätig. Die Gruppe entwickelt, produziert und verkauft im Bereich Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik. Hauptkunden sind der Automobilsektor und die Halbleiterindustrie, wo diese Geräte für ähnliche Zwecke eingesetzt werden.

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

In 2002 und 2001 wurden mit keinem Kunden 10% oder mehr des Konzernumsatzes erzielt.

	2002	2001
Externe Umsatzerlöse - Produkte		
Deutschland	55.462	55.583
USA	41.648	99.816
Frankreich	11.719	13.707
Japan	10.125	29.232
Sonstige Länder	1.555	5.016
Gesamt	120.510	203.354
Externe Umsatzerlöse - Service		
Deutschland	2.516	2.444
USA	2.155	8.007
Frankreich	741	529
Japan	1.089	0
Sonstige Länder	494	435
Gesamt	7.005	11.415
Langfristige Aktiva		
Deutschland	21.460	18.628
USA	8.085	11.795
Frankreich	2.798	2.705
Japan	2.476	1.459
Sonstige Länder	956	112
Konsolidierung	-2.669	-1.778
Gesamt	33.106	32.931

VI.5 VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der Konzerngesellschaft im Jahr 2002 waren:

Herr Dr. Franz Richter, Dipl.-Ingenieur, Eichenau (Vorstandsvorsitzender), Herr Claus Lichtenberg, Dipl.-Ingenieur., München (bis 31.10.2002), Herr Stephan Schulak, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach (stellvertretendes Mitglied)

	fix	variabel
Bezüge in EUR	612.387	21.984

Weiterhin wurden aufgrund der in 1999, 2000 und 2001 an Vorstände gewährten Optionen TEUR 1.015 als Personalaufwand in der Holding erfasst. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Lichtenberg in der Wartefrist wurden kumulativ für die Jahre 2003 bis 2006 die rech-nerischen Werte in Höhe von TEUR 402 bereits in 2002 zugeführt.

Es erfolgten hieraus aber keinerlei Zahlungen an die Vorstände.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2002:

Dr. Winfried Süß, München, Aufsichtsratsvorsitzender
weitere Mandate: ISiT, Itzehoe, (Kurator)

Thomas Schlytter-Henrichsen, Kronberg/Taunus, Geschäftsführer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Christoph Schücking, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt

weitere Mandate: Lambda Physik AG, Göttingen (Mitglied im Aufsichtsrat)
Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA., Frankfurt a. M. (Mitglied im Gesellschafterausschuss)
Freudenberg & Co., Weinheim (Mitglied im Gesellschafterausschuss)
Kennametal Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)
Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Prof. Dr. Anton Heuberger, München, Professor an der TU CAU Kiel

weitere Mandate: West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)
IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)
Institut f. Oberflächenmodifizierung e. V., Leipzig, (Kurator)
MicroParts Gesellschaft für Mikrostrukturtechnik mbH, Karlsruhe, (Mitglied im Aufsichtsrat)
Sensor Dynamics, Graz, Austria (Mitglied im Aufsichtsrat)
Solid Energy, Itzehoe, (Mitglied im Beirat)

Dr. Thomas Sesselmann, Tittmoning, Geschäftsführer

weitere Mandate: ETEL S.A., Motiers, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrates)
Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Präsident und Mitglied Board of Directors)
Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)
Renco Endocoders Inc. Goleta, CA., USA (Mitglied Board of Directors)
ACU-RITE Inc., Jamestown, NY., USA (Mitglied Board of Directors)

Horst Görtz, Neu-Anspach

weitere Mandate: AC Service AG, Stuttgart (Aufsichtsratsvorsitzender)
Ultimaco Safeware AG, Oberursel (Aufsichtsratsvorsitzender)
GITS AG, Bochum (Aufsichtsratsvorsitzender)

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr insgesamt EUR 42.182.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum 31.12.2002:

	Aktien	Optionen
Dr. Franz Richter	400.000	65.000
Stephan Schulak	0	286
Dr. Winfried Süß	1.039.780	0
Thomas Schlytter-Henrichsen	6.909	0
Dr. Christoph Schücking	500	0
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	0
Dr. Thomas Sesselmann	0	0
Horst Görtz	3.894	0

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2002

VI.6 MITARBEITER

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 941 Mitarbeiter (2001: 955 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2002	2001
Verwaltung	136	119
Marketing und Vertrieb	262	240
Produktion und Technik	480	586
Summe	878	955

Aufgrund der Restrukturierung wird die Mitarbeiterzahl von 878 (davon 30 Auszubildende) in 2003 noch um weitere 112 Mitarbeiter reduziert.

In den at equity einbezogenen Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter 19 (2001: 19 Mitarbeiter) tätig.

VI.7 CORPORATE GOVERNANCE

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben die nach §161 AktG in Verbindung mit §15EGAktG vorgeschriebene Erklärung im Dezember 2002 abgegeben und im Internet unter www.suss.de dauerhaft zugänglich gemacht.

VI.8 MITTEILUNGEN GEMÄSS WPHG

Herr Dr. Süß, Deutschland, hat uns am 13.02.2002 mitgeteilt, dass ihm am 12.02.2002 6,36% (entspricht 950.000 Stammaktien) der Stimmrechte an der SÜSS MicroTec AG, zustehen. Wir weisen darauf hin, dass diese Meldung mit der Kapitalerhöhung vom Januar 2003 zusammenhängt. Herr Dr. Süß verfügte nach der Kapitalerhöhung über einen unveränderten Bestand an Aktien.

Die M&G Limited, London, Großbritannien, hat der Gesellschaft am 08.02.2003 mitgeteilt, dass am 18.01.2003 infolge einer Kapitalerhöhung die Schwelle von 5% unterschritten wurde und ihr 4,61% (entspricht 689.056 Stammaktien) der Stimmrechte an der SÜSS MicroTec AG, Garching, zustehen.

Die Capital Guardian Trust Company, Los Angeles, USA, hat der Gesellschaft am 21.04.2002 mitgeteilt, dass ihr am 01.04.2002 6,49% (entspricht 968.700 Stammaktien) der Stimmrechte an der SÜSS MicroTec AG, Garching, zustehen.

Die Nobel S.A., Paris, Frankreich, hat der Gesellschaft am 22.01.2003 mitgeteilt, dass ihr am 15.01.2003 5,08% (entspricht 760.000 Stammaktien) der Stimmrechte an der SÜSS MicroTec AG, Garching, zustehen.

Garching, 20. März 2003
Der Vorstand



Dr. Franz Richter



Stephan Schulak



| **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben die von der Süss MicroTec AG aufgestellte konsolidierte Bilanz und die zugehörige konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung sowie Anhangsangaben (Konzernabschluss) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles - US-GAAP) liegen in der Verantwortung des Vorstands. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den US-GAAP entspricht.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung stellt der oben genannte Konzernabschluss die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2002 sowie dessen Ertragslage und Zahlungsströme für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2002 in Übereinstimmung mit den US-GAAP in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

Unsere Prüfung, die sich auch auf den vom Vorstand aufgestellten, mit dem Lagebericht der SMT AG zusammengefassten, Konzernlagebericht, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht zusammen mit den übrigen Angaben des Konzernabschlusses insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen.

München, den 21. März 2003

PRICEWATERHOUSECOOPERS

GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Reitmeier) (ppa. Eichler)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



| **SÜSS MicroTec AG**

Schleissheimer Strasse 90
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07- 0
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-359

E-Mail: ir@suss.de
www.suss.de